

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特許公報(B2)

(11) 特許番号

特許第4491332号
(P4491332)

(45) 発行日 平成22年6月30日(2010.6.30)

(24) 登録日 平成22年4月9日(2010.4.9)

(51) Int.Cl.

H01L 21/027 (2006.01)
G03F 7/20 (2006.01)

F 1

H01L 21/30 516C
G03F 7/20 521

請求項の数 17 外国語出願 (全 46 頁)

(21) 出願番号 特願2004-327534 (P2004-327534)
 (22) 出願日 平成16年11月11日 (2004.11.11)
 (65) 公開番号 特開2005-183938 (P2005-183938A)
 (43) 公開日 平成17年7月7日 (2005.7.7)
 審査請求日 平成19年3月29日 (2007.3.29)
 (31) 優先権主張番号 530662
 (32) 優先日 平成15年12月19日 (2003.12.19)
 (33) 優先権主張国 米国(US)

(73) 特許権者 502120538
 エーエスエムエル マスクツールズ ピー
 ブイ.
 オランダ国 ヴェルトホーフェン 550
 4 ディー アール, デ ラン 6501
 (74) 代理人 100079108
 弁理士 稲葉 良幸
 (74) 代理人 100093861
 弁理士 大賀 真司
 (74) 代理人 100109346
 弁理士 大貫 敏史
 (72) 発明者 ロバート ソチャ
 アメリカ合衆国、カリフォルニア、キャム
 ベル、モンテ ヴィラ コート 137

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】最適化した偏光照明

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項 1】

基板の表面に形成すべきパターンの照明の偏光を最適化する方法であって、
 (a) 少なくとも二つの偏光状態について照明器上の少なくとも一つの点に対して照
 明強度を決める工程、
 (b) 前記少なくとも二つの偏光状態について前記照明器上の前記少なくとも一つの
 点に対して画像対数勾配 (ILS) を決める工程、
 (c) 前記 ILS が前記照明器上の前記少なくとも一つの点に対して少なくともゼロ
 に近い、最大画像対数勾配 (ILS) を決める工程、および
 (d) 前記照明器上の前記少なくとも一つの点に対して前記最大 ILS に対応する最
 適偏光状態を選ぶ工程、を含む方法。

【請求項 2】

前記照明器上の複数の点の各々に対して工程 (a) ~ (d) を反復する工程をさらに含
 む請求項 1 に記載された照明の偏光を最適化する方法。

【請求項 3】

形態の対称性に関して前記照明器の一部上の複数の点の各々に対して工程 (a) ~ (d)
) を反復する工程をさらに含む請求項 1 に記載された照明の偏光を最適化する方法。

【請求項 4】

前記照明器の半分上の複数の点の各々に対して工程 (a) ~ (d) を反復する工程をさ
 らに含む請求項 1 に記載された照明の偏光を最適化する方法。

10

20

【請求項 5】

前記パターンの最適照明を創成するために、前記照明器上の複数の点の各々に対して最適偏光状態を組合わせる工程をさらに含む請求項 2 に記載された照明の偏光を最適化する方法。

【請求項 6】

前記最適偏光状態が前記少なくとも二つの偏光状態の変形である請求項 1 に記載された照明の偏光を最適化する方法。

【請求項 7】

前記最適偏光状態が前記少なくとも二つの偏光状態の一つに対応する請求項 1 に記載された照明の偏光を最適化する方法。 10

【請求項 8】

前記少なくとも二つの偏光状態が少なくとも X および Y 偏光状態を含む請求項 1 に記載された照明の偏光を最適化する方法。

【請求項 9】

少なくとも一つの機械読み取り可能媒体により可搬の実行可能コードを含むコンピュータ・プログラムプロダクトに於いて、少なくとも一つのプログラム式コンピュータによる前記コードの実行が前記少なくとも一つのプログラム式コンピュータに、基板の表面に形成すべきパターン用の偏光照明を最適化するための一連の工程を行わせ、

(a) 少なくとも二つの偏光状態について照明器上の少なくとも一つの点に対して照明強度を計算する工程、 20

(b) 前記少なくとも二つの偏光状態について前記照明器上の前記少なくとも一つの点に対して画像対数勾配 (ILS) を計算する工程、

(c) 前記 ILS の勾配が前記照明器上の前記少なくとも一つの点に対して少なくともゼロに近い、最大画像対数勾配 (ILS) を決める工程、および

(d) 前記照明器上の前記少なくとも一つの点について前記最大 ILS に対する最適偏光状態を選ぶ工程、を含むプログラムプロダクト。

【請求項 10】

プロダクト前記照明器上の複数の点の各々に対して工程 (a) ~ (d) を反復する工程をさらに含む請求項 9 に記載されたコンピュータ・プログラムプロダクト。

【請求項 11】

形態の対称性に関して前記照明器の一部上の複数の点の各々に対して工程 (a) ~ (d) を反復する工程をさらに含む請求項 9 に記載されたコンピュータ・プログラムプロダクト。

【請求項 12】

前記照明器の半分上の複数の点の各々に対して工程 (a) ~ (d) を反復する工程をさらに含む請求項 9 に記載されたコンピュータ・プログラムプロダクト。

【請求項 13】

前記パターンの最適照明を創成するために、前記照明器上の複数の点の各々に対して最適偏光状態を組合わせる工程をさらに含む請求項 9 に記載されたコンピュータ・プログラムプロダクト。 40

【請求項 14】

前記最適偏光状態が前記少なくとも二つの偏光状態の変形である請求項 9 に記載されたコンピュータ・プログラムプロダクト。

【請求項 15】

前記最適偏光状態が前記少なくとも二つの偏光状態の一つに対応する請求項 9 に記載されたコンピュータ・プログラムプロダクト。

【請求項 16】

前記少なくとも二つの偏光状態が少なくとも X および Y 偏光状態を含む請求項 9 に記載された照明器の偏光を最適化する方法。

【請求項 17】

10

20

30

40

50

プロセスウインドウを増大するために最適化した偏光照明を使ってマスク設計を基板の目標部分上に生み出す装置であって、

偏光した放射線の投影ビームを供給するための放射線システム、

前記放射線の投影ビームを受け且つ放射線の調整したビームをマスクの一部に投影するための照明器、および

マスクの対応する被照射部分を前記基板の前記目標部分上に結像するための投影システム、を含み、

前記照明器が複数の画素で前記複数の画素の各々での偏光および強度を最適化するように調整してあり、

前記複数の画素の各々での偏光および強度を、

10

(a) 少なくとも二つの偏光状態について照明器上の少なくとも一つの画素に対して照明強度を決める工程、

(b) 前記少なくとも二つの偏光状態について前記照明器上の前記少なくとも一つの画素に対して画像対数勾配 (ILS) を決める工程、

(c) 前記ILSが前記照明器上の前記少なくとも一つの画素に対して少なくともゼロに近い、最大画像対数勾配 (ILS) を決める工程、

(d) 前記照明器上の前記少なくとも一つの画素に対して前記最大ILSに対応する最適偏光状態を選ぶ工程、および

(e) 前記照明器上の前記複数の画素の各々に対して工程 (a) ~ (d) を反復する工程、

20

を実行することによって最適化するように構成したコンピュータシステムをさらに含む装置。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

この特許出願、およびそれから発行されたいずれの特許も、2003年12月19日に提出した、“偏光で最適化したリソグラフィ照明”という名称の米国仮特許出願第60/530,662号からの優先権を主張し、その出願全体を参考までにここに援用する。

【0002】

この技術分野は、一般的には、基板の表面に形成すべきパターンの照明分布のために偏光を最適化するためのマイクロリソグラフィの方法およびプログラムプロダクトに関する。

30

【背景技術】

【0003】

リソグラフィ装置は、例えば、集積回路 (IC) の製造に使うことができる。そのような場合、マスクがこのICの個々の層に対応する回路パターンを含んでもよく、このパターンを、放射線感應性材料（レジスト）の層で塗被した基板（シリコンウエハ）の目標部分（例えば、一つ以上のダイを含む）上に結像することができる。一般的に、單一ウエハが隣接する目標部分の全ネットワークを含み、それらをこの投影システムを介して、一度に一つずつ、順次照射する。ある種類のリソグラフィ投影装置では、全マスクパターンをこの目標部分上に一度に露光することによって各目標部分を照射し、そのような装置を普通ウエハステッパと呼ぶ。普通ステップアンドスキャン装置と呼ぶ、代替装置では、マスクパターンを投影ビームの下で与えられた基準方向（“走査”方向）に順次走査することによって各目標部分を照射し、一方、基板テーブルをこの方向に平行または逆平行に同期して走査する。一般的に、投影システムの倍率がM（一般的に<1）であるので、この基板テーブルを走査する速度Vは、倍率M掛けるマスクテーブルを走査する速度である。ここに説明したようなリソグラフィ装置に関する更なる情報は、例えば、米国特許第6,046,792号明細書から収集することができ、それを参考までにここに援用する。

40

【0004】

リソグラフィ投影装置を使う製造プロセスでは、マスクパターンを、少なくとも部分的

50

に放射線感応材料（レジスト）の層で覆われた基板上に結像する。この結像工程の前に、基板は、例えば、下塗り、レジスト塗布およびソフトベークのような、種々の処理を受けるかも知れない。露光後、基板は、例えば、露光後ベーク（P E B）、現像、ハードベークおよび結像形態の測定／検査のような、他の処理を受けるかも知れない。この一連の処理は、デバイス、例えばICの個々の層をパターン化するための基礎として使用する。そのようにパターン化した層は、次に、エッチング、イオン注入（ドーピング）、金属化処理、酸化処理、化学・機械的研磨等のような、全て個々の層の仕上げを意図した種々の処理を受けるかも知れない。もし、幾つかの層が必要ならば、全処理またはその変形を各新しい層に反復しなければならないだろう。結局、デバイスのアレイが基板（ウエハ）上にできる。次に、これらのデバイスをダイシングまたは鋸引のような手法によって互いから分離し、そこから個々のデバイスをキャリヤに取付け、ピンに接続する等できる。

【0005】

簡単のために、この投影システムを、以後“レンズ”と呼ぶかも知れないが、この用語は、例えば、屈折性光学素子、反射性光学素子、および反射屈折性光学素子を含む、種々の型式の投影システムを包含するように広く解釈すべきである。この放射線システムも放射線の投影ビームを指向し、成形したまたは制御するためにこれらの設計形式の何れかに従って作用する部品を含んでもよく、そのような部品も以下で集合的または単独に“レンズ”と呼ぶかも知れない。更に、このリソグラフィ装置は、二つ以上の基板テーブル（および／または二つ以上のマスクテーブル）を有する型式でもよい。そのような“多段”装置では、追加のテーブルを並列に使ってもよく、または準備工程を一つ以上のテーブルで行い、一方他の一つ以上のテーブルを露光に使ってもよい。二段階リソグラフィ装置は、例えば、米国特許第5,969,441号明細書に記載してあり、それを参考までにここに援用する。

【0006】

上に言及したフォトリソグラフィマスクは、シリコンウエハ上に集積すべき回路部品に相当する幾何学的パターンを含む。そのようなマスクを創成するために使うパターンは、CAD（コンピュータ支援設計）プログラムを使って生成し、このプロセスをしばしばEDA（電子的設計自動化）と呼ぶ。大抵のCADプログラムは、機能的マスクを創成するために一組の所定のデザインルールに従う。これらのルールは、処理および設計限界によって設定してある。例えば、デザインルールは、回路素子（例えば、ゲート、コンデンサ等）または接続線が互いに望ましくない方法で影響し合わないことを保証するように、これらの回路素子または線間のスペース許容差を定める。これらのデザインルール限界を典型的には“限界寸法”CDと呼ぶ。回路の限界寸法は、線若しくは孔の最小幅または二つの線若しくは二つの孔の間の最小スペースと定義することができる。それで、CDが設計した回路の全体のサイズまたは密度を決める。

【0007】

勿論、集積回路製作での目標の一つは、ウエハ上に元の回路設計を忠実に再現することである（マスクを介して）。もう一つの目標は、半導体ウエハ実体財産をできるだけ多く使うことである。更にもう一つの目標は、照明を最適化し、ウエハ上の像のコントラストを向上することである。全体のプロセスウインドウ（即ち、指定したCDの形態を、その形態が孤立しているか、隣接する形態に関して密に詰っているかに關係なく、一貫してプリントする能力）を増すことによって、これらの目標の各々をより容易に達成できるかも知れない。

【0008】

全体的プリント性能を改善するように源照明およびマスクパターンを最適化する方法は、先行技術に開示してある。そのような方法の一つは、ローゼンブルース外の米国特許第6,563,566号明細書であり、それを参考までにここに援用する。具体的に言えば、ローゼンブルースは、与えられたマスクパターンのプリントを改善するために源照明およびマスクパターンの最適化を行うことを主張するリソグラフィ最適化システムを開示している。この源／マスクパターンの最適組合せを決めるためにローゼンブルースが使った

10

20

30

40

50

価値ある関数は、パターン幾何形状の境界に沿って予め選択した多数の点での空中像対数勾配である。この最適化アルゴリズムは、リソグラフィパターンのプリントが単に結像瞳で収集した複数次回折の集合によって決り、瞳面でのそれらの位置に無関係であるという仮定に基づくようだ。

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0009】

パターンの選択したサンプリング位置での空中像対数勾配の最大化は、普通露光ラチチュード（E L）と呼ぶ、露光変動に対するバジェット／許容差を拡大するが、普通焦点深度（D O F）と呼ぶ、焦点変動に対するバジェット／許容差を増大するのには役立たない。実際、合焦条件下で（即ち、D O F ゼロで）E Lを最適化したパターンは、ピンぼけ変動を受入れる典型的プロセス条件に対して最適化したパターンに比べて、相補の結果を示すことが知られている。もう一つの問題は、不均一なラインプリントの発生、即ち、レジストに作ったラインの中間点でのコントラストがラインの端の点でのコントラストより大きいことである。従って、E Lを向上するように、形態を高精度でプリントするために照明を最適化することが望ましい。

【0010】

偏光は、大抵の照明には存在するが、レジストでの入射角が浅いので、低開口数（N A）のシステムには無視できる。従って、偏光からのどのマイナスまたはプラスの影響も極小である。上に言及したように、フォトリソグラフィ結像は、予想通りに次第に小さい形態サイズの方へ移行している。小さい形態を得る一つの方法は、N Aを増すことである。しかし、レジストでの入射角が増し、それで偏光によって生じるマイナス効果が増大し、画像コントラストが小さくなる。従って、特に高N Aシステムでは、これらの問題を克服することが望ましい。

【課題を解決するための手段】

【0011】

開示した構想は、基板の表面に形成すべきパターンのために照明を最適化する方法を含む。この方法は、少なくとも二つの偏光状態について照明器上の少なくとも一つの点に対して照明強度を決める工程を含む。更に、これら少なくとも二つの偏光状態についてこの照明器上のこの少なくとも一つの点に対して画像対数勾配（I L S）を決める。これらの値に基づいて、このI L Sがこの照明器上のこの少なくとも一つの点に対して少なくともゼロに近い、最大画像対数勾配（I L S）を決め、およびこの照明器上のこの少なくとも一つの点に対してこの最大I L Sに対応する最適偏光状態を選ぶ。従って、偏光した照明をこの照明器上のこの少なくとも一つの点に対して最適化するだろう。このプロセスをこの照明器上の複数の点の各々に対して反復してもよい。この照明器上の複数の点の各々に対して最適偏光状態を組合わせることによって、このパターンの最適照明を決める。この最適偏光状態は、これら少なくとも二つの偏光状態の変形、若しくは組合せでもよく、またはこれら少なくとも二つの偏光状態の一つに対応してもよい。その上、これら少なくとも二つの偏光状態が少なくともXおよびY偏光状態を含んでもよい。

【0012】

上に説明した構想は、少なくとも一つの機械読取可能な媒体により可搬の実行可能コードを含むコンピュータ・プログラムプロダクトによって実現してもよく、少なくとも一つのプログラム式コンピュータによるこのコードの実行がこの少なくとも一つのプログラム式コンピュータに、基板の表面に形成すべきパターン用の偏光照明を最適化するための一連の工程を行わせる。このコンピュータ・プログラムプロダクトは、少なくとも二つの偏光状態について照明器上の少なくとも一つの点に対して照明強度を計算し、これら少なくとも二つの偏光状態についてこの照明器上のこの少なくとも一つの点に対して画像対数勾配（I L S）を計算し、画像対数勾配（I L S）がこの照明器上のこの少なくとも一つの点に対して少なくともゼロに近い、最大画像対数勾配（I L S）を決め、およびこれら少なくとも二つの偏光状態に対応し、この照明器上のこの少なくとも一つの点についてI L

10

20

30

40

50

Sを最小にする最適偏光状態を選ぶ。このコンピュータ・プログラムプロダクトは、上に議論した工程をこの照明器上の複数の点の各々に対して反復してもよい。

【0013】

開示した構想の更にもう一つの態様は、プロセスウインドウを増大するために最適化した偏光照明を使ってマスク設計を生み出す装置を含む。この装置は、偏光した放射線の投影ビームを供給するための放射線システム、この放射線の投影ビームを受け且つ放射線の調整したビームをマスクの一部に投影するための照明器、およびマスクの対応する被照射部分を基板の目標部分上に結像するための投影システムを含む。この照明器は、複数の点でこれらの複数の点の各々での偏光および強度を最適化するように調整してある。その上、この装置は、この複数の点の各々での偏光および強度を、少なくとも二つの偏光状態について照明器上の少なくとも一つの点に対して照明強度を決る工程、これら少なくとも二つの偏光状態についてこの照明器上のこの少なくとも一つの点に対して画像対数勾配(ILS)を決める工程、このILSがこの照明器上のこの少なくとも一つの点に対して少なくともゼロに近い、最大画像対数勾配(ILS)を決める工程、これら少なくとも二つの偏光状態に対応し、この照明器上のこの少なくとも一つの点についてILSを最小にする最適偏光状態を選ぶ工程；およびこの照明器上のこれら複数の点の各々に対してこれらの工程を反復する工程を実行することによって最適化するように構成したコンピュータシステムを含む。10

【0014】

本発明の前記およびその他の特徴、態様、および利点は、以下の本発明の詳細な説明を添付の図面と共に検討すれば、より明白となろう。20

【実施例】

【0015】

マイクロリソグラフィで、フォトレジスト層に付ける画像の解像度は、光学システムの開口数(NA)を増すと向上する。高解像度では、高いプロセスウインドウが可能である。しかし、そのようなシステムは、空気を通る回折によって制限される。高NAのシステムは、光学システムのレンズとウエハ上のフォトレジスト層の間に水を加えることによって達成可能であることが分っていて、屢々浸漬リソグラフィと呼ばれる。しかし、光学システムのNAを増すことによって、フォトレジストへの電界のマイナス効果も強まる。それで、高NAを維持しながら、電界のマイナス効果を減少することが望ましい。これらのマイナスの電界効果を減少する一つの方法は、照明を偏光することである。偏光した照明は、露光ラチチュードおよびプロセスウインドウを乾式システムでも同様に増大することが分っている。30

【0016】

各成分が互いに直交し、光学ではしばしば“S偏光”および“P偏光”と呼ばれる、2種類の偏光がある。S偏光では、電界が常に光の伝播方向と直角を成す。光が常にこの伝播方向と直角であるために、S偏光の二つの光ビームが干渉するとき、当業者によく知られているように、それらは非常によいコントラストを成す。P偏光に関しては、電界が光の伝播平面内にあって、相殺的干渉を生じ、それがある場合には好ましい。結果として、高NAシステムでは、SおよびP偏光ができるだけ最適化するのが望ましい。40

【0017】

しばしば偏光をXおよびY偏光と呼ぶことがある。それにも拘らず、SおよびPとXおよびY偏光との間の関係はよく知られている。P偏光は、マスク形態と直角を成す方向(Y方向に向いたマスク形態についてのX方向)に対応する。S偏光は、このマスク形態と平行な方向(Y方向に向いたマスク形態についてのY方向)に対応する。数学的には、P偏光は、

$$\hat{p} = \hat{x} \cos \phi + \hat{y} \sin \phi$$

によって X および Y 偏光と関係付けられ、並びに S 偏光は、

$$\hat{s} = -\hat{x} \sin \phi + \hat{y} \cos \phi$$

によって X および Y 偏光と関係付けられ、ここで

$$\phi = \tan^{-1}(B/\alpha)$$

10

並びに座標

$$\alpha$$

および

$$\beta$$

20

を決めてよい。

【 0 0 1 8 】

図 1 A は、例示的な煉瓦壁孤立マイクロリソグラフィ・マスクパターンを示し図 1 B は、そのパターンを結像するための照明器を示す。図 1 B の照明器上の点は、軸 s および s を有するデカルト座標グリッドによって表してもよく、この照明器上の各点をレチクル上の空中像、または照明強度を決めるために解析してもよい。図 1 C - 1 および図 1 C - 2 は、それぞれ、図 1 B の照明器上の点 2 での X および Y 偏光の空中像を示す。図 1 C - 3 および図 1 C - 4 は、それぞれ、図 1 B の照明器上の点 4 での X および Y 偏光の空中像を示す。

【 0 0 1 9 】

具体的言うと、図 1 C - 1 および図 1 C - 2 は、それぞれ、照明器上の点 2 ($s, 0.78; s, 0.46$) についてマスクでの X 偏光およびマスクでの Y 偏光の空中像を示す。これらの空中像で分るように、Y 偏光(図 1 C - 2)は、X 偏光(図 1 C - 1)よりコントラストがよい。従って、Y 偏光を最大化し且つ X 偏光(図 1 C - 1)を制限するように両 X および Y 偏光を考慮に入れて照明器を設計するのが望ましいだろう。

【 0 0 2 0 】

また、マスクでの X 偏光およびマスクでの Y 偏光の空中像(それぞれ、図 1 C - 3 および図 1 C - 4)を参照すると、点 4 ($s, 0.02; s, 0.02$) についての X 偏光(図 1 C - 3)が Y 偏光(図 1 C - 4)よりコントラストがよい。従って、照明器上のこの点では、X 偏光を最大化することが望ましいだろう。

【 0 0 2 1 】

その結果、各セルまたは照明器の点の間で X 偏光および Y 偏光のバランスを取ることによって、全体の照明を最適化し、既存のシステムよりコントラストまたは解像度を良くする結果となる。

【 0 0 2 2 】

照明器上の各点を、最適コントラストの空中像を作る偏光状態を決めるために解析してもよい。しかし、前記の方法で照明器の複数の点について空中像を手作業で解析することは、かなり時間が掛る。本発明者は、偏光した照明を最適化するための更に新規な手法を案出した。

【 0 0 2 3 】

30

40

50

図2は、本開示に従って照明強度を最適化するために使ったプロセスの流れ図を示す。最初に、ステップ20で、セルの種類（例えば、所望のマスクパターンの領域）およびフラグメンテーション点（例えば、このセルに含まれる点）を選択する。図4Aおよび図16Aに示すように、このセルに例示的煉瓦壁マスクパターンをを選択し、且つ三つのフラグメンテーション点1、2、および3を選択した。これらの点は、それぞれ、ラインの端（フラグメンテーション点1）、ラインの中間（フラグメンテーション点2）、および二つのラインを橋絡する点（フラグメンテーション点3）に対応する。どんなフラグメンテーション点の番号を与えられたセルに選んでもよく、屢々このパターンの複雑さに依る。説明目的で、三つのフラグメンテーション点を選び、汎用形態型式を表す。勿論、更に多くのフラグメンテーション点を使えば、ここに説明する最適化手法の精度を増す。

10

【0024】

図2に戻って参考して、ステップ21で、ウエハ面（像面）の各点(x, y)での強度を、アッベ(Abbe)の結像の理論を使って、各偏光状態 $J_x(s, s)$ および $J_y(s, s)$ に対して照明器面の各点(s, s)から決める。照明点(s, s)での強度から生じるウエハ点(x, y)での強度伝達関数を表す、 $I(s, s; x, y)$ に関する式を生成してもよい。与えられた方法で強度を決めるための方程式は、当業者に知られている。強度伝達関数、 $I(s, s; x, y)$ を式3.0（後に議論する）に示す。

【0025】

ステップ22で、正規化画像対数勾配(NILS)または画像対数勾配(ILS)を各偏光状態 $J_x(s, s)$ および $J_y(s, s)$ に対しておよび各フラグメンテーション点(x, y)で決める。この強度決定に次いで、画像対数勾配(ILS)を式1.0に従って決めてよい。

20

【0026】

【数1】

$$\text{式1.0} \rightarrow ILS(x, y) = \hat{n} \bullet \nabla \ln[I(x, y)] = \hat{n} \bullet \hat{n} \bullet \left[\hat{x} \frac{\partial I(x, y)}{\partial x} + \hat{y} \frac{\partial I(x, y)}{\partial y} \right] \frac{1}{I(x, y)}$$

【0027】

30

実際問題として、式2.0によって与えられるように、ILSを正規化するのが最善である。

【0028】

【数2】

$$\text{式2.0} \rightarrow NILS(x, y) = w \hat{n} \bullet \nabla \ln[I(x, y)]$$

但し、wは、CDまたは/ λ NAのような長さの単位を伴う正規化係数である。

【0029】

40

結果として、 $I(s, s; x, y)$ およびNILS($s, s; x, y$)が決定されてもよい。式3.0は、式1.0および2.0に加えた $I(x, y)$ に相当する。

【0030】

【数3】

$$\text{式3.0} \rightarrow I(x, y) = \iint d\alpha_s d\beta_s \left\{ J_x(\alpha_s, \beta_s) [I_{xx}(\alpha_s, \beta_s; x, y) + I_{yx}(\alpha_s, \beta_s; x, y) + I_{zx}(\alpha_s, \beta_s; x, y)] \right. \\ \left. + J_y(\alpha_s, \beta_s) [I_{xy}(\alpha_s, \beta_s; x, y) + I_{yy}(\alpha_s, \beta_s; x, y) + I_{zy}(\alpha_s, \beta_s; x, y)] \right\}$$

【0031】

50

但し：

I_{x_x} は、物体面で x 方向偏光を伴うフィールドから生じる像面での x 方向の強度を表し、

I_{y_x} は、物体面で x 方向偏光を伴うフィールドから生じる像面での y 方向の強度を表し、

I_{z_x} は、物体面で x 方向偏光を伴うフィールドから生じる像面での z 方向の強度を表し、

I_{x_y} は、物体面で y 方向偏光を伴うフィールドから生じる像面での x 方向の強度を表し、

I_{y_y} は、物体面で y 方向偏光を伴うフィールドから生じる像面での y 方向の強度を表し、および 10

I_{z_y} は、物体面で y 方向偏光を伴うフィールドから生じる像面での z 方向の強度を表す。

【0032】

スペースを節約するために、式 1.0 を拡張するための以下の式（式 4.0 および 4.1）では、全ての強度、 I 、および全ての電界成分、 E 、に対して (x, y) を省略し、並びに (s_s, s_s) を全ての照明強度 J_x および J_y に対して省略した。

【0033】

【数4】

$$\text{式 4.0} \rightarrow \frac{\partial I}{\partial x} = \iint d\alpha_s d\beta_s \left[J_x \left(\frac{\partial I_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial I_{yx}}{\partial x} + \frac{\partial I_{zx}}{\partial x} \right) + J_y \left(\frac{\partial I_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial I_{yy}}{\partial x} + \frac{\partial I_{zy}}{\partial x} \right) \right]$$

$$\text{式 4.1} \rightarrow \frac{\partial I}{\partial y} = \iint d\alpha_s d\beta_s \left[J_x \left(\frac{\partial I_{xx}}{\partial y} + \frac{\partial I_{yx}}{\partial y} + \frac{\partial I_{zx}}{\partial y} \right) + J_y \left(\frac{\partial I_{xy}}{\partial y} + \frac{\partial I_{yy}}{\partial y} + \frac{\partial I_{zy}}{\partial y} \right) \right]$$

【0034】

$$I_{xx} = E_{xx} E_{xx}^*$$

またはより一般的に強度および電界成分に対して、 ij は、像面での偏光状態、 j による、物体面での偏光状態、 i を表し、且つ式 5.0 の一般的表記法によって与えられる。

$$\text{式 5.0} \rightarrow I_{ij} = E_{ij} E_{ij}^*$$

【0035】

式 4.0 および 4.1 は、以下の方法で更に拡張してもよい。

20

30

40

【数5】

$$\frac{\partial I_{xx}}{\partial x} = \frac{\partial E_{xx}}{\partial x} E_{xx}^* + E_{xx} \frac{\partial E_{xx}^*}{\partial x} \quad \frac{\partial I_{ij}}{\partial x} = \frac{\partial E_{ij}}{\partial x} E_{ij}^* + E_{ij} \frac{\partial E_{ij}^*}{\partial x}$$

$$\frac{\partial I_{xx}}{\partial y} = \frac{\partial E_{xx}}{\partial y} E_{xx}^* + E_{xx} \frac{\partial E_{xx}^*}{\partial y} \quad \frac{\partial I_{ij}}{\partial y} = \frac{\partial E_{ij}}{\partial y} E_{ij}^* + E_{ij} \frac{\partial E_{ij}^*}{\partial y}$$

$$\frac{\partial E_{xx}}{\partial x} = j2\pi \left(\frac{m}{P_x} + \frac{NA\alpha_s}{\lambda} \right) E_{xx} \quad \frac{\partial E_{ij}}{\partial x} = j2\pi \left(\frac{m}{P_x} + \frac{NA\alpha_s}{\lambda} \right) E_{ij}$$

$$\frac{\partial E_{xx}^*}{\partial x} = -j2\pi \left(\frac{m}{P_x} + \frac{NA\alpha_s}{\lambda} \right) E_{xx}^* \quad \frac{\partial E_{ij}^*}{\partial x} = -j2\pi \left(\frac{m}{P_x} + \frac{NA\alpha_s}{\lambda} \right) E_{ij}^*$$

$$\frac{\partial E_{xx}}{\partial y} = j2\pi \left(\frac{n}{P_y} + \frac{NA\beta_s}{\lambda} \right) E_{xx} \quad \frac{\partial E_{ij}}{\partial y} = j2\pi \left(\frac{n}{P_y} + \frac{NA\beta_s}{\lambda} \right) E_{ij}$$

$$\frac{\partial E_{xx}^*}{\partial y} = -j2\pi \left(\frac{n}{P_y} + \frac{NA\beta_s}{\lambda} \right) E_{xx}^* \quad \frac{\partial E_{ij}^*}{\partial y} = -j2\pi \left(\frac{n}{P_y} + \frac{NA\beta_s}{\lambda} \right) E_{ij}^*$$

$$E_{xx} = \exp \left[jx2\pi \left(\frac{m}{P_x} + \frac{NA\alpha_s}{\lambda} \right) \right] \exp \left[jy2\pi \left(\frac{n}{P_y} + \frac{NA\beta_s}{\lambda} \right) \right] F(m,n) P_{xx} \left(\alpha_s + \frac{m\lambda}{P_x NA}, \beta_s + \frac{n\lambda}{P_y NA} \right)$$

$$E_{ij} = \exp \left[jx2\pi \left(\frac{m}{P_x} + \frac{NA\alpha_s}{\lambda} \right) \right] \exp \left[jy2\pi \left(\frac{n}{P_y} + \frac{NA\beta_s}{\lambda} \right) \right] F(m,n) P_{ij} \left(\alpha_s + \frac{m\lambda}{P_x NA}, \beta_s + \frac{n\lambda}{P_y NA} \right)$$

$$E_{ij}^* = \exp \left[-jx2\pi \left(\frac{m}{P_x} + \frac{NA\alpha_s}{\lambda} \right) \right] \exp \left[-jy2\pi \left(\frac{n}{P_y} + \frac{NA\beta_s}{\lambda} \right) \right] F^*(m,n) P_{ij}^* \left(\alpha_s + \frac{m\lambda}{P_x NA}, \beta_s + \frac{n\lambda}{P_y NA} \right)$$

【0036】

但し、 P_{ij} は、物体面（レチクル面）から像面（ウエハ面）への画像伝達関数である。
 P_{ij} で、 j は物体での偏光状態であり、 i は像での偏光状態である。縮小システムでは、 x および y 偏光だけを物体面 j で使い、並びに x 、 y 、および z 偏光を像面 i で使う。
 伝達関数 P_{ij} は、D.G. フラゲロ外の“均質薄膜での高NA結像の理論”、米国光学学会雑誌、A 第13巻、第1号、1996年1月、53ページで与えられ、以下に式6.0で再現する。

【0037】

【数6】

$$\text{式 6.0} \rightarrow \begin{bmatrix} P_{xx} & P_{xy} \\ P_{yx} & P_{yy} \\ P_{zx} & P_{zy} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_s & F_p & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & F_s & F_p & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & F_{zp} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_{xss} & P_{yss} \\ P_{xsp} & P_{yps} \\ P_{sys} & P_{yys} \\ P_{xyp} & P_{ypy} \\ P_{xzp} & P_{yzp} \end{bmatrix}$$

【0038】

ステップ23で、最適化制約条件を選択し、それには、典型的に、“ツアイス仕様書”

10

20

30

40

50

のような、照明システムの仕様（または制限条件）がある。これらの仕様には、典型的には、例えば、最小瞳充满 10 %、および例えば、最小リング幅 0.2 のような、製造制約条件がある。他の最適化制約条件を選んでもよく、それらは十分当業者のレベルの範囲内にあることを注記する。上に議論した計算および最適化制約条件の組に基づいて、ステップ 2.4 で、最小 N I L S を最大化する照明点強度および偏光状態を各フラグメンテーション点 (x, y) で選択する。式 7.0 によって以下に示すように、式 6.8 を積分することによって、最小 N I L S を最大化する照明点強度および偏光状態を決める。

【0039】

【数 7】

10

$$\text{式 7.0} \rightarrow \max_{\{J_x(\alpha_s, \beta_s), J_y(\alpha_s, \beta_s)\}} [\min\{ILS_1(x, y), ILS_2(x, y), \dots, ILS_n(x, y)\}]$$

【0040】

このミニマックス問題を、ブрайトン、R. K. 外の“準ニュートン法および関数分割に基づく統計的回路設計のための新しいアルゴリズム” IEEE 会報、回路およびシステムズ、CAS-26巻、pp. 784-794、1979年9月を参考にして、逐次クオドラティックプログラミングを使って解く。

【0041】

N I L S は、露光ラチチュードまたは E L と直接相関関係を有する。各フラグメンテーション点での最大最小 N I L S（即ち、勾配が 0 または 0 に近いところの最大点）は、最大露光ラチチュード（E L）を表す。言換えれば、N I L S は、画像コントラストの尺度である。理想的環境で、N I L S プロットは、垂直エッジ（勾配無限大）および水平面（勾配 0）を有する、形態の断面を正確に表すだろう。最小 N I L S を最大化することは、理想的形態に最も近い。従って、N I L S が最大になる照明器上の各点で、空中像は、最良のコントラストを示すだろう。

20

【0042】

ステップ 2.5 で、今度は $J_x(s, s)$ および $J_y(s, s)$ を合計して、照明パターンを創成するために所望の強度で各フラグメンテーション点 (x, y) での最小 N I L S を最大化するために最適照明を決める。

30

【0043】

上に説明したように、照明器上の各点を解析する。しかし、照明器上の全点を解析する必要はなく、与えられたパターンの対称性に依存する。与えられたパターンが 2 軸の周りに対称であれば、照明器の四半分だけを解析すればよい。これは、ここで議論した煉瓦壁パターンの例で見られる。逆に、パターンが 1 軸周りに対称であれば、照明器の半分だけを解析すればよい。更に、全てではないにしても、大抵のパターンで、照明器は、与えられたパターンが X および / または Y 軸周りに対称でなくても、ある種の対称性を有する。大抵の場合、照明器の半分だけを解析すればよい。

【0044】

これらのステップの後に、上で解析した各点に対応する各画素を最適化することによって、実際の照明器を創成してもよい。しかし、どの画素または画素のグループを前記の手法に従って最適化するかを決めるために所定の基準に従ってもよい。勿論、当業者は、どの画素を最適化するかを決めるために所定に基準を設定することができる。所定に基準は、照明器、スキヤナ等の種類および与えられたパターンにありうるものとに従っている。

40

【0045】

図 3 は、上に説明したような照明の最適化に好適なコンピュータシステム 3.0 を示す。このコンピュータシステムは、各偏光状態について照明器上の各点の強度を決めるための照明シミュレータ 3.1 を含む。この照明および偏光状態に基づいて、画像対数勾配シミュレータ 3.2 が I L S または N I L S を発生する。最大照明点強度シミュレータ 3.3 が I L S シミュレータ 3.2 の出力に基づいて最小 I L S または N I L S を最大化する。照明器上

50

の各点に対する計算を促進するために、フィードバック経路 3 4 が設けてある。最後に、最適照明器シミュレータ 3 5 が、この照明器の各点を表す計算に基づいて最適照明器を創成する。

【 0 0 4 6 】

以下の例は、上に議論した手法を使って、浸漬式システムと乾式システムの両方のための偏光照明を最適化する。

【 0 0 4 7 】

例 1 - 浸漬式システム

図 4 A を参照すると、マイクロリソグラフィマスクの長さ 0 . 4 nm、幅 0 . 2 nm の区画に対する煉瓦壁孤立パターン 4 0 が示してある。更に、数字 1、2 および 3 によって示す三つのフラグメンテーション点が図示してある。上述のように、フラグメンテーション点 1 は、煉瓦壁パターン 4 0 のライン形態 4 2 の端に対応し、フラグメンテーション点 2 は、ライン形態 4 2 の中間点に対応し、およびフラグメンテーション点 3 は、ライン 4 2 と 4 4 の接続部に対応する。

【 0 0 4 8 】

図 4 B は、浸漬式システム用ウエハの構造を示し、それに図 4 A の煉瓦壁パターン 4 0 を適用した。波長 λ が 193 nm、開口数 NA が 1 . 2 の照明システム（以下に説明）を使った。

【 0 0 4 9 】

図 5 A - 1 ないし図 5 A - 3 および図 5 B - 1 ないし図 5 B - 3 は、基板への投影瞳の伝達を表すシミュレーションを示す。例えば、X 偏光を有するマスクでの照明は、ウエハで他の偏光状態に影響するかも知れない。これは、次の式によって表すことができる。

【 0 0 5 0 】

伝達関数 P_{ij} は、D . G . フラゲロ外の“均質薄膜での高 NA 結像の理論”、米国光学学会雑誌、A 第 13 卷、第 1 号、1996 年 1 月、53 ページで与えられる。 P_{ij} を以下に示す。

【 0 0 5 1 】

【 数 8 】

$$\begin{bmatrix} P_{xx} & P_{xy} \\ P_{yx} & P_{yy} \\ P_{zx} & P_{zy} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_s & F_p & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & F_s & F_p & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & F_{zp} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_{xss} & P_{yss} \\ P_{xxp} & P_{yxp} \\ P_{xys} & P_{yys} \\ P_{xyp} & P_{ypy} \\ P_{xzp} & P_{yzp} \end{bmatrix}$$

【 0 0 5 2 】

図 5 A - 1 ~ 図 5 A - 3 は、マスク（マスク E x ）での X 偏光およびウエハ（それぞれ、ウエハ E x 、ウエハ E y 、およびウエハ E z ）での偏光状態に対するシミュレーションを示す。図 5 B - 1 ~ 図 5 B - 3 は、マスク（マスク E y ）での Y 偏光、およびウエハ（それぞれ、ウエハ E x 、ウエハ E y 、およびウエハ E z ）での偏光状態に対するシミュレーションを示す。予測通り、マスク E x およびウエハ E x の偏光（図 5 A - 1 ）並びにマスク E y およびウエハ E y の偏光（図 5 B - 2 ）は、最適コントラストを達成できる状態を示す。即ち、もし、全ての光を強引に瞳部分 5 0 を通過させるように照明器を設計できたなら、最適コントラストが得られるだろう。図 5 A - 2 、図 5 A - 3 、図 5 B - 1 、および図 5 B - 3 と違って、ウエハでの偏光状態および強度は、散発的で、コントラストの低下を生じるだろう。

【 0 0 5 3 】

10

20

30

40

50

図6は、最適化した未偏光状態について対応する等高線プロットおよび照明強度を示す。対照的に、図7および図8は、それぞれ、最適化した偏光状態および最適化したTE偏光状態について対応する等高線プロットおよび照明強度を示す。これらの等高線プロットの比較によって分るよう、最適化した偏光(図7)または最適化したTE偏光(図8)は、最適化した未偏光照明(図6)より優れた照明をもたらす。具体的言うと、優れた照明は、図6のプロットと比較するとき、図7および図8のプロットの極に沿って見られるプロットの膨張性によって表される。

【0054】

図7および図8は、更に、図7の複数の偏光ベクトル70および図8の複数の偏光ベクトル80によって定義される偏光の状態を示す。偏光ベクトル70、80によって示すように、照明器上のある対応点では、Y偏光だけが望ましく、そして、他の点ではX偏光だけが望ましい。図7を図8と比較すると、偏光ベクトル70は、偏光ベクトル80より急激に変化する。この急激な変化は、画像のコントラストを改善するので、より望ましい。

10

【0055】

図9～図11は、それぞれ、図4Aの煉瓦壁パターン上の点1、2、および3での照明瞳NILS応答プロットを示す。図9～図11の副図A-1およびA-2は、X偏光に対するこれらの点でのNILS応答プロットを示し、一方副図B-1およびB-2は、Y偏光に対するこれらの点でのNILS応答プロットを示す。各フラグメンテーション点について、XおよびY偏光の比較は、Y偏光が良い照明であることを示す。例えば、図9の副図A-1およびA-2と副図B-1およびB-2を比較すれば、Y偏光に対する照明強度(図9のB-1およびB-2)がX偏光より約300%の改善を示す。具体的に言えば、強度レベル90は、強度レベル92より遙かに小さい。それで、フラグメンテーション点1については、X偏光に優先してY偏光を使えば、照明強度を劇的に改善する。

20

【0056】

フラグメンテーション点2に関して、図10は、対応する瞳NILS反応プロットを示す。やはり、強度表現100と強度表現102の比較によって示すように、Y偏光は、X偏光より約300%改善する。フラグメンテーション点3に関して(図11)は、110の強度レベルを112のそれと比較することによって、X偏光がY偏光より40%の改善を示す。それで、フラグメンテーション点3では、X偏光を使うのが好ましい。

30

【0057】

図12～図14は、それぞれ、最適化した未偏光照明、最適化した偏光照明および最適化したTE偏光照明のための、図4Bのウエハ構造による図4Aの煉瓦壁パターンのプリントのシミュレーションを示す。フォーカス-0.3から0.1までの空中像を、それぞれ、0.05刻みで図12～図14について副図A～Iによって示す。各副図は、フォーカスを介して煉瓦壁とレジストの空中像を示す。それぞれのフォーカス図の比較から、フォーカス-0.1(図12E、図13Eおよび図14E)が最善のコントラストの煉瓦壁を示す傾向がある。今度は、各図の煉瓦壁像を比較すると、図13Eおよび図14Eは、図12Eのそれより僅かに良いコントラストを示す。従って、最適化した偏光(図13E)および最適化したTE偏光(図14E)が最適化した未偏光照明(図12E)のそれより高いコントラストを生じる。

40

【0058】

代って、図15A～図15Cは、それぞれ、未偏光照明、偏光照明およびTE偏光照明についての図4Aの煉瓦壁のフラグメンテーション点1、2および3に対する、フォーカスを介するILSプロットを示す。上に議論したように、最大ILSを最小化することによって、偏光照明を最適化してもよい。図15A～図15Cのプロットは、この独特の特徴を示す。具体的に言うと、フラグメンテーション点1(図15A)で、偏光照明がILS最大で、一方未偏光照明は、ILS最小である。TE偏光照明は、間にに入る。同じことがフラグメンテーション点2(図15B)についても、フラグメンテーション点3(図15C)についても真である。言換えれば、最低画像対数勾配が未偏光の場合に対応し、最高画像対数勾配が偏光した場合に対応する。

50

【0059】

高い画像対数勾配は、高コントラストを生じ、それが次に露光ラチチュードの増加および良いプロセスウインドウをもたらす。従って、上に説明し、図2の流れ図に従って決めたように、各フラグメンテーション点で偏光を最適化することによって、高いプロセスウインドウが得られるかも知れない。

【0060】**例2 - 乾式システム**

図4Aのように、図16は、数字1、2および3によって示す三つのフラグメンテーション点を有する、マイクロリソグラフィマスクの長さ0.4nm、幅0.2nmの区画に対する半ピッチ煉瓦壁孤立パターン160を示す。しかし、図16Bは、図16Aの煉瓦壁パターン160を適用する、乾式システム用ウエハ構造を示す。乾式システムでは、空気の透過率が1である。再び、波長が193nm、開口数NAが1.2の照明システム(以下に説明)を使った。

10

【0061】

図17A-1～図17A-3および図17B-1～図17B-3は、図5によって示したものと同じである。従って、ウエハを水に浸したか乾式かに拘らず、投影瞳は同じままである。この図の説明は、簡潔のために繰返さない。

【0062】

図18は、最適化した未偏光状態のための対応する等高線プロットおよび照明強度を示す。これとは対照的に、図19および図20は、それぞれ、最適化した偏光状態および最適化したTE偏光状態のための対応する等高線プロットおよび照明強度を示す。浸漬式システムの場合同様、最適化した偏光(図19)または最適化したTE偏光(図20)は、最適化した未偏光照明(図18)より優れた照明をもたらす。図19および図20は、更に、図19の複数の偏光ベクトル190および図20の複数の偏光ベクトル200によって定義される偏光状態を示す。偏光ベクトル190、200によって示すように、照明器上のある点では、Y偏光だけが望ましく、および他の点ではX偏光だけが望ましい。前同様、偏光ベクトル190は、偏光ベクトル200より急激に変化し、従ってより望ましく、良いコントラストをもたらす。

20

【0063】

図21～図23は、それぞれ、図16Aの煉瓦壁パターン上の点1、2、および3での照明瞳NILS応答プロットを示す。図21～図23の副図A-1およびA-2は、X偏光に対するこれらの点でのNILS応答プロットを示し、一方副図B-1およびB-2は、Y偏光に対するこれらの点でのNILS応答プロットを示す。各フラグメンテーション点について、XおよびY偏光の比較は、X偏光に対して優れた照明を示す。図21の副図A-1およびA-2と副図B-1およびB-2を比較すれば、Y偏光に対する照明強度(図21のB-1およびB-2)がX偏光より約50%の改善を示す。具体的に言えば、強度レベル212は、強度レベル210より50%の改善を示す。それで、フラグメンテーション点1については、X偏光に優先してY偏光を使えば、照明強度を改善する。

30

【0064】

フラグメンテーション点2に関して、図22は、対応する瞳NILS反応プロットを示す。やはり、Y偏光は、強度レベル220と強度レベル222の比較によって示すように、X偏光より50%改善する。フラグメンテーション点3に関して(図23)は、X偏光がY偏光より40%の改善を示す。それで、フラグメンテーション点3では、X偏光を使うのが好ましい。

40

【0065】

図24～図26は、それぞれ、最適化した未偏光照明、最適化した偏光照明および最適化したTE偏光照明のための、図16Bのウエハ構造による図16Aの煉瓦壁パターンのプリントのシミュレーションを示す。フォーカス-0.3から0.1までの空中像を、それぞれ、0.05刻みで図24～図26の各々の副図A～Iによって示す。各副図は、フォーカスを介して煉瓦壁とレジストの空中像を示す。それぞれのフォーカス図の比較から

50

、フォーカス - 0 . 1 (図 24 E 、 図 25 E および図 26 E) が最高のコントラストの煉瓦壁を示す傾向がある。今度は、各図の煉瓦壁像を比較すると、図 25 E および図 26 E は、図 24 E のそれより僅かに良いコントラストを示す。従って、最適化した偏光 (図 25 E) および最適化した TE 偏光 (図 26 E) が最適化した未偏光照明 (図 24 E) のそれより高いコントラストの像を生じる。

【 0066 】

代って、図 27 A ~ 図 27 C は、それぞれ、未偏光照明、偏光照明および TE 偏光照明についての図 16 A の煉瓦壁のフラグメンテーション点 1 、 2 および 3 に対する、フォーカスを介する ILS プロットを示す。上に議論したように、最大 NILS を最小化することによって、偏光照明を最適化してもよい。フラグメンテーション点 1 (図 27 A) で、 TE 方位照明が最大 ILS を有し、一方未偏光照明は、最小 ILS を有する。同じことがフラグメンテーション点 2 (図 27 B) についても真である。しかし、フラグメンテーション点 3 (図 27 C) については、最適化した偏光が約 15 % だけ未偏光照明より ILS を改善する。

10

【 0067 】

結論として、高画像対数勾配が高コントラストを生じ、それが次に広い露光ラチチュードおよび良いプロセスウインドウを得る。従って、上に説明し、図 2 の流れ図に従って決めたように、各フラグメンテーション点で偏光を最適化することによって、高いプロセスウインドウが得られるだろう。

【 0068 】

20

図 28 は、本発明を使って設計したマスクと共に使うのに適したリソグラフィ投影装置を概略的に描く。この装置は :

- 放射線の投影ビーム PB を供給するための、この特別な場合放射線源 LA も含む、放射線システム EX 、 IL ;
- マスク MA (例えば、レチクル) を保持するためのマスクホルダを備え、且つこのマスクを部材 PL に関して正確に位置決めするために第 1 位置決め手段に結合された第 1 物体テーブル (マスクテーブル) MT ;
- 基板 W (例えば、レジストを塗被したシリコンウェハ) を保持するための基板ホルダを備え、且つこの基板を部材 PL に関して正確に位置決めするために第 2 位置決め手段に結合された第 2 物体テーブル (基板テーブル) WT ; および
- マスク MA の被照射部分を基板 W の目標部分 C (例えば、一つ以上のダイを含む) 上に結像するための投影システム (“ レンズ ”) PL (例えば、屈折性、反射性または反射屈折性光学システム) を含む。

30

【 0069 】

ここに描くように、この装置は、反射型である (即ち、反射性のマスクを有する) 。しかし、一般的に、それは、例えば、 (透過性マスクを備える) 透過型でもよい。その代りに、この装置は、マスクの使用に対する代案としての別の種類のパターニング手段を使ってよく、その例にはプログラム可能ミラーアレイまたは LCD マトリックスがある。

【 0070 】

40

この線源 LA (例えば、水銀灯またはエキシマレーザ) は、放射線のビームを作る。このビームを直接か、または、例えば、ビーム拡大器 EX のような、状態調節手段を通してから、照明システム (照明器) IL の中へ送る。この照明器 IL は、このビームの強度分布の外側および / または内側半径方向範囲 (普通、それぞれ、外側および / または 内側と呼ぶ) を設定するための調整手段 AM を含んでもよい。その上、それは、一般的に、積分器 IN およびコンデンサ CO のような、種々の他の部品を含む。この様にして、マスク MA に入射するビーム PB は、その断面に所望の均一性および強度分布を有する。

【 0071 】

図 28 に関して、線源 LA は、 (この線源 LA が、例えば、水銀灯である場合によくあることだが) このリソグラフィ投影装置のハウジング内にあってもよいが、このリソグラフィ投影装置から遠く離れていて、それが作る放射線ビームをこの装置に (例えば、適當

50

な指向ミラーを使って)導いてもよいことに注目すべきで、この後者のシナリオは、線源 L A がエキシマレーザ(例えば、K r F、A r F または F₂ レージングに基づく)である場合によくあることである。本発明は、少なくともこれらのシナリオの両方を包含する。

【 0 0 7 2 】

ビーム P B は、次に、マスクテーブル M T 上に保持されたマスク M A で反射される。マスク M A で反射されてから、ビーム P B は、レンズ P L を通過し、それがこのビーム P B を基板 W の目標部分 C 上に集束する。第 2 位置決め手段(および干渉計測定手段 I F)を使って、基板テーブル W T を、例えば、異なる目標部分 C をビーム P B の経路に配置するように、正確に動かすことができる。同様に、例えば、マスク M A をマスクライブラリから機械的に検索してから、または走査中に、第 1 位置決め手段を使ってマスク M A をビーム P B の経路に関して正確に配置することができる。一般的に、物体テーブル M T 、W T の移動は、図 28 にはっきりは示さないが、長ストロークモジュール(粗位置決め)および短ストロークモジュール(精密位置決め)を使って実現する。しかし、ウエハステッパーの場合は(ステップアンドスキャン装置と違って)、マスクテーブル M T を短ストロークアクチュエータに結合するだけでもよく、または固定してもよい。

【 0 0 7 3 】

図示する装置は、二つの異なるモードで使うことができる。

- ステップモードでは、マスクテーブル M T を本質的に固定して保持し、全マスク像を目標部分 C 上に一度に(即ち、単一“フラッシュ”で)投影する。次に基板テーブル W T を x および / または y 方向に移動して異なる目標部分 C をビーム P B で照射できるよう 10 にする。

- 走査モードでは、与えられた目標部分 C を単一“フラッシュ”では露光しないことを除いて、本質的に同じシナリオを適用する。その代りに、マスクテーブル M T が与えられた方向(所謂“走査方向”、例えば、y 方向)に速度 v で可動で、それで投影ビーム P B がマスク像の上を走査させられ、同時に、基板テーブル W T がそれと共に同じまたは反対方向に速度 V = M v で動かされ、この M はレンズ P L の倍率(典型的には、M = 1 / 4 または 1 / 5)である。この様にして、比較的大きい目標部分 C を、解像度について妥協する必要なく、露光することができる。

【 0 0 7 4 】

ここに開示した構想は、波長以下の形態を結像するため一般的結像システムのどれをシミュレートまたは数学的にモデル化してもよく、且つ益々小さくなる波長を作り出せる新興の結像技術に特に有用かも知れない。既に使われている新興技術には、A r F レーザを使って 193 nm、および弗素レーザを使って 157 nm の波長さえも作り得る E U V(超紫外線)リソグラフィがある。更に、E U V リソグラフィは、シンクロトロンを使うことによって 20 ~ 5 nm の範囲内の波長を、またはこの範囲内の光子を作るために高エネルギー電子で材料(固体またはプラズマのいずれか)を叩くことによってこの波長を作ることができる。大抵の材料はこの範囲内で吸収性であるので、照明をモリブデンとシリコンの多層反射性ミラーで作ってもよい。この多層ミラーは、モリブデンとシリコンの対の 40 層を有し、各層の厚さは、波長の四分の一である。X 線リソグラフィで更に短い波長さえも作れる。典型的には、シンクロトロンを使って X 線波長を作る。大抵の材料は、x 線波長で吸収性であるので、吸収材料の薄片が、形態が写る(ポジレジスト)場所か、写らない(ネガレジスト)場所を決める。

【 0 0 7 5 】

ここに開示した構想は、シリコンウエハのような基板上に結像するために使ってもよいが、開示した構想は、どんな種類のリソグラフィ結像システム、例えば、シリコンウエハ以外の基板上に結像するためのもの、にも使ってよいことを理解すべきである。

【 0 0 7 6 】

実行可能コードを含む、プログラミングを伴うコンピュータシステムのソフトウェア機能面を上に説明した結像モデルを実行するために使ってもよい。このソフトウェアコードは、汎用コンピュータで実行可能である。作動する際は、コードとことによると関連する

10

20

30

40

50

データ記録を汎用コンピュータプラットフォーム内に記憶する。しかし、ほかの時は、このソフトウェアを適当な汎用コンピュータシステムにローディングするために他の場所に記憶しあり／または移送してもよい。従って、上に議論した実施例は、少なくとも一つの機械読み取り可能媒体が記憶する一つ以上のコードのモジュールの形の一つ以上のソフトウェアプロダクトを必要とする。コンピュータシステムのプロセッサによるそのようなコードの実行は、実質的にここに議論し且つ図示した実施例で行った方法で、このプラットフォームにカタログおよび／またはソフトウェア・ダウンローディング機能を実行できるようとする。

【0077】

ここで使うように、コンピュータまたは機械“読み取り可能媒体”というような用語は、プロセッサへの実行命令の提供に参加するあらゆる媒体を指す。そのような媒体は、多くの形を探ることができ、それには不揮発性媒体、揮発性媒体、および伝送媒体があるがそれらに限定されない。不揮発性媒体には、例えば、上に議論した、サーバプラットフォームの一つとして動作する何れかのコンピュータの何れかの記憶装置のような、光または磁気ディスクがある。揮発性媒体には、そのようなコンピュータプラットフォームの主記憶装置のような、ダイナミックメモリがある。物理的伝送媒体には、コンピュータシステム内のバスを構成するワイヤを含む、同軸ケーブル、銅線および光ファイバがある。搬送波伝送媒体は、無線周波（RF）および赤外線（IR）データ通信中に発生するもののような、電気若しくは電磁信号、または音波若しくは光波の形を探ることができる。従って、コンピュータ可読媒体の共通の形には、例えば、フロッピー（登録商標）ディスク、フレキシブルディスク、ハードディスク、磁気テープ、何か他の磁気媒体、CD-ROM、DVD、その他の光媒体、パンチカード、紙テープ、孔のパターンを備えるその他の物理的媒体のような普通あまり使われない媒体、RAM、ROM、およびEPROM、フラッシュEPROM、何か他のメモリチップまたはカートリッジ、データまたは命令を移送する搬送波、そのような搬送波を移送するケーブルまたはリンク、またはコンピュータがプログラムコードおよび／またはデータを読み出せる何か他の媒体がある。コンピュータ読み取り可能媒体のこれらの形の多くがプロセッサへ一つ以上の系列の一つ以上の命令を実行のために搬送する際に関わってもよい。

【0078】

本発明を詳細に説明し且つ図示したが、それは説明と例示だけのためであり、限定とどるべきでなく、本発明の範囲は、添付の請求項の条件によってのみ制限されることを明確に理解すべきである。

【図面の簡単な説明】

【0079】

【図1A】例示的な煉瓦壁パターンを示す。

【図1B】上記パターンを結像するための照明器を示す。

【図1C-1】図1Bの照明器上の点2に対応する空中像を示す。

【図1C-2】図1Bの照明器上の点2に対応する空中像を示す。

【図1C-3】図1Bの照明器上の点4に対応する空中像を示す。

【図1C-4】図1Bの照明器上の点4に対応する空中像を示す。

【図2】本発明に従って偏光照明を最適化するための例示的流れ図を示す。

【図3】本発明に従って偏光照明を最適化するように構成した例示的コンピュータシステムを示す。

【図4A】三つのフラグメンテーション基準点を備える例示的半ピッチ煉瓦壁孤立パターン・マイクロリソグラフィマスク形態を示す。

【図4B】浸漬式システム用ウエハの構造を示す。

【図5A-1】マスクに適用したX偏光用投影瞳、およびウエハにできたX偏光状態を示す。

【図5A-2】マスクに適用したX偏光用投影瞳、およびウエハにできたy偏光状態を示す。

10

20

30

40

50

【図5A-3】マスクに適用したX偏光用投影瞳、およびウエハにできたz偏光状態を示す。

【図5B-1】マスクに適用したY偏光用投影瞳、およびウエハにできたx偏光状態を示す。

【図5B-2】マスクに適用したY偏光用投影瞳、およびウエハにできたy偏光状態を示す。

【図5B-3】マスクに適用したY偏光用投影瞳、およびウエハにできたz偏光状態を示す。

【図6】図4Bのウエハ構造で図4Aの煉瓦壁パターン用の最適化した未偏光照明を示す。

10

【図7】図4Bのウエハ構造で図4Aの煉瓦壁パターン用の最適化した偏光照明を示す。

【図8】図4Bのウエハ構造で図4Aの煉瓦壁パターン用の最適化したTE方位偏光照明を示す。

【図9A-1】二つの強度範囲についてのX偏光用フラグメンテーション点1の照明瞳NILS応答プロットを示す。

【図9A-2】二つの強度範囲についてのX偏光用フラグメンテーション点1の照明瞳NILS応答プロットを示す。

【図9B-1】二つの強度範囲についてのY偏光用フラグメンテーション点1の照明瞳NILS応答プロットを示す。

【図9B-2】二つの強度範囲についてのY偏光用フラグメンテーション点1の照明瞳NILS応答プロットを示す。

【図10A-1】二つの強度範囲についてのX偏光用フラグメンテーション点2の照明瞳NILS応答プロットを示す。

20

【図10A-2】二つの強度範囲についてのX偏光用フラグメンテーション点2の照明瞳NILS応答プロットを示す。

【図10B-1】二つの強度範囲についてのY偏光用フラグメンテーション点2の照明瞳NILS応答プロットを示す。

【図10B-2】二つの強度範囲についてのY偏光用フラグメンテーション点2の照明瞳NILS応答プロットを示す。

【図11A-1】二つの強度範囲についてのX偏光用フラグメンテーション点3の照明瞳NILS応答プロットを示す。

30

【図11A-2】二つの強度範囲についてのX偏光用フラグメンテーション点3の照明瞳NILS応答プロットを示す。

【図11B-1】二つの強度範囲についてのY偏光用フラグメンテーション点3の照明瞳NILS応答プロットを示す。

【図11B-2】二つの強度範囲についてのY偏光用フラグメンテーション点3の照明瞳NILS応答プロットを示す。

【図12A】最適化した未偏光照明のための、図4Bのウエハ構造による図4Aの煉瓦壁パターンのプリントのシミュレーションをフォーカス-0.3で示す。

【図12B】最適化した未偏光照明のための、図4Bのウエハ構造による図4Aの煉瓦壁パターンのプリントのシミュレーションをフォーカス-0.25で示す。

40

【図12C】適化した未偏光照明のための、図4Bのウエハ構造による図4Aの煉瓦壁パターンのプリントのシミュレーションをフォーカス-0.2で示す。

【図12D】適化した未偏光照明のための、図4Bのウエハ構造による図4Aの煉瓦壁パターンのプリントのシミュレーションをフォーカス-0.15で示す。

【図12E】適化した未偏光照明のための、図4Bのウエハ構造による図4Aの煉瓦壁パターンのプリントのシミュレーションをフォーカス-0.1で示す。

【図12F】適化した未偏光照明のための、図4Bのウエハ構造による図4Aの煉瓦壁パターンのプリントのシミュレーションをフォーカス-0.05で示す。

【図12G】適化した未偏光照明のための、図4Bのウエハ構造による図4Aの煉瓦壁パ

50

ターンのプリントのシミュレーションをフォーカス0で示す。

【図12H】適化した未偏光照明のための、図4Bのウエハ構造による図4Aの煉瓦壁パターンのプリントのシミュレーションをフォーカス0.05で示す。

【図12I】適化した未偏光照明のための、図4Bのウエハ構造による図4Aの煉瓦壁パターンのプリントのシミュレーションをフォーカス0.1で示す。

【図13A】最適化した偏光照明のための、図4Bのウエハ構造による図4Aの煉瓦壁パターンのプリントのシミュレーションをフォーカス-0.3で示す。

【図13B】最適化した偏光照明のための、図4Bのウエハ構造による図4Aの煉瓦壁パターンのプリントのシミュレーションをフォーカス-0.25で示す。

【図13C】最適化した偏光照明のための、図4Bのウエハ構造による図4Aの煉瓦壁パターンのプリントのシミュレーションをフォーカス-0.2で示す。

【図13D】最適化した偏光照明のための、図4Bのウエハ構造による図4Aの煉瓦壁パターンのプリントのシミュレーションをフォーカス-0.15で示す。

【図13E】最適化した偏光照明のための、図4Bのウエハ構造による図4Aの煉瓦壁パターンのプリントのシミュレーションをフォーカス-0.1で示す。

【図13F】最適化した偏光照明のための、図4Bのウエハ構造による図4Aの煉瓦壁パターンのプリントのシミュレーションをフォーカス-0.05で示す。

【図13G】最適化した偏光照明のための、図4Bのウエハ構造による図4Aの煉瓦壁パターンのプリントのシミュレーションをフォーカス0で示す。

【図13H】最適化した偏光照明のための、図4Bのウエハ構造による図4Aの煉瓦壁パターンのプリントのシミュレーションをフォーカス0.05で示す。

【図13I】最適化した偏光照明のための、図4Bのウエハ構造による図4Aの煉瓦壁パターンのプリントのシミュレーションをフォーカス0.1で示す。

【図14A】最適化したTE偏光照明のための、図4Bのウエハ構造による図4Aの煉瓦壁パターンのプリントのシミュレーションをフォーカス-0.3で示す。

【図14B】最適化したTE偏光照明のための、図4Bのウエハ構造による図4Aの煉瓦壁パターンのプリントのシミュレーションをフォーカス-0.25で示す。

【図14C】最適化したTE偏光照明のための、図4Bのウエハ構造による図4Aの煉瓦壁パターンのプリントのシミュレーションをフォーカス-0.2で示す。

【図14D】最適化したTE偏光照明のための、図4Bのウエハ構造による図4Aの煉瓦壁パターンのプリントのシミュレーションをフォーカス-0.15で示す。

【図14E】最適化したTE偏光照明のための、図4Bのウエハ構造による図4Aの煉瓦壁パターンのプリントのシミュレーションをフォーカス-0.1で示す。

【図14F】最適化したTE偏光照明のための、図4Bのウエハ構造による図4Aの煉瓦壁パターンのプリントのシミュレーションをフォーカス-0.05で示す。

【図14G】最適化したTE偏光照明のための、図4Bのウエハ構造による図4Aの煉瓦壁パターンのプリントのシミュレーションをフォーカス0で示す。

【図14H】最適化したTE偏光照明のための、図4Bのウエハ構造による図4Aの煉瓦壁パターンのプリントのシミュレーションをフォーカス0.05で示す。

【図14I】最適化したTE偏光照明のための、図4Bのウエハ構造による図4Aの煉瓦壁パターンのプリントのシミュレーションをフォーカス0.1で示す。

【図15A】図4Aに示すフラグメンテーション点1での画像対数勾配(ILS)プロットを示す。

【図15B】図4Aに示すフラグメンテーション点2での画像対数勾配(ILS)プロットを示す。

【図15C】図4Aに示すフラグメンテーション点3での画像対数勾配(ILS)プロットを示す。

【図16A】三つのフラグメンテーション基準点を備える半ピッチ煉瓦壁孤立パターン・マイクロリソグラフィマスク形態を示す。

【図16B】乾式システム用ウエハの構造を示す。

10

20

30

40

50

【図17A-1】マスクに適用したX偏光用投影瞳、およびウエハにできたX偏光状態を示す。

【図17A-2】マスクに適用したX偏光用投影瞳、およびウエハにできたy偏光状態を示す。

【図17A-3】マスクに適用したX偏光用投影瞳、およびウエハにできたz偏光状態を示す。

【図17B-1】マスクに適用したY偏光用投影瞳、およびウエハにできたX偏光状態を示す。

【図17B-2】マスクに適用したY偏光用投影瞳、およびウエハにできたy偏光状態を示す。

【図17B-3】マスクに適用したY偏光用投影瞳、およびウエハにできたz偏光状態を示す。

【図18】図16Bのウエハ構造で図16Aの煉瓦壁パターン用の最適化した未偏光照明を示す。

【図19】図16Bのウエハ構造で図16Aの煉瓦壁パターン用の最適化した偏光照明を示す。

【図20】図16Bのウエハ構造で図16Aの煉瓦壁パターン用の最適化したTE方位偏光照明を示す。

【図21A-1】二つの強度範囲についてのX偏光用フラグメンテーション点1の照明瞳NILS応答プロットを示す。

20

【図21A-2】二つの強度範囲についてのX偏光用フラグメンテーション点1の照明瞳NILS応答プロットを示す。

【図21B-1】二つの強度範囲についてのY偏光用フラグメンテーション点1の照明瞳NILS応答プロットを示す。

【図21B-2】二つの強度範囲についてのY偏光用フラグメンテーション点1の照明瞳NILS応答プロットを示す。

【図22A-1】二つの強度範囲についてのX偏光用フラグメンテーション点2の照明瞳NILS応答プロットを示す。

【図22A-2】二つの強度範囲についてのX偏光用フラグメンテーション点2の照明瞳NILS応答プロットを示す。

30

【図22B-1】二つの強度範囲についてのY偏光用フラグメンテーション点2の照明瞳NILS応答プロットを示す。

【図22B-2】二つの強度範囲についてのY偏光用フラグメンテーション点2の照明瞳NILS応答プロットを示す。

【図23A-1】二つの強度範囲についてのX偏光用フラグメンテーション点3の照明瞳NILS応答プロットを示す。

【図23A-2】二つの強度範囲についてのX偏光用フラグメンテーション点3の照明瞳NILS応答プロットを示す。

【図23B-1】二つの強度範囲についてのY偏光用フラグメンテーション点3の照明瞳NILS応答プロットを示す。

40

【図23B-2】二つの強度範囲についてのY偏光用フラグメンテーション点3の照明瞳NILS応答プロットを示す。

【図24A】最適化した未偏光照明のための、図16Bのウエハ構造による図16Aの煉瓦壁パターンのプリントのシミュレーションをフォーカス-0.3で示す。

【図24B】最適化した未偏光照明のための、図16Bのウエハ構造による図16Aの煉瓦壁パターンのプリントのシミュレーションをフォーカス-0.25で示す。

【図24C】最適化した未偏光照明のための、図16Bのウエハ構造による図16Aの煉瓦壁パターンのプリントのシミュレーションをフォーカス-0.2で示す。

【図24D】最適化した未偏光照明のための、図16Bのウエハ構造による図16Aの煉瓦壁パターンのプリントのシミュレーションをフォーカス-0.15で示す。

50

【図24E】最適化した未偏光照明のための、図16Bのウエハ構造による図16Aの煉瓦壁パターンのプリントのシミュレーションをフォーカス-0.1で示す。

【図24F】最適化した未偏光照明のための、図16Bのウエハ構造による図16Aの煉瓦壁パターンのプリントのシミュレーションをフォーカス-0.05で示す。

【図24G】最適化した未偏光照明のための、図16Bのウエハ構造による図16Aの煉瓦壁パターンのプリントのシミュレーションをフォーカス0で示す。

【図24H】最適化した未偏光照明のための、図16Bのウェハ構造による図16Aの煉瓦壁パターンのプリントのシミュレーションをフォーカス0.05で示す。

【図24-I】最適化した未偏光照明のための、図16Bのウェハ構造による図16Aの煉瓦壁パターンのプリントのシミュレーションをフォーカス0.1で示す。

【図25A】最適化した偏光照明のための、図16Bのウエハ構造による図16Aの煉瓦壁パターンのプリントのシミュレーションをフォーカス-0.3で示す。

【図25B】最適化した偏光照明のための、図16Bのウエハ構造による図16Aの煉瓦壁パターンのプリントのシミュレーションをフォーカス-0.25で示す。

【図25C】最適化した偏光照明のための、図16Bのウエハ構造による図16Aの煉瓦壁パターンのプリントのシミュレーションをフォーカス-0.2で示す。

【図25D】最適化した偏光照明のための、図16Bのウエハ構造による図16Aの煉瓦壁パターンのプリントのシミュレーションをフォーカス-0.15で示す。

【図25E】最適化した偏光照明のための、図16Bのウエハ構造による図16Aの煉瓦壁パターンのプリントのシミュレーションをフォーカス-0.1で示す。

【図25F】最適化した偏光照明のための、図16Bのウエハ構造による図16Aの煉瓦壁パターンのプリントのシミュレーションをフォーカス-0.05で示す。

【図25G】最適化した偏光照明のための、図16Bのウエハ構造による図16Aの煉瓦壁パターンのプリントのシミュレーションをフォーカス0で示す。

【図25H】最適化した偏光照明のための、図16Bのウエハ構造による図16Aの煉瓦壁パターンのプリントのシミュレーションをフォーカス0.05で示す。

【図25Ⅰ】最適化した偏光照明のための、図16Bのウエハ構造による図16Aの煉瓦壁パターンのプリントのシミュレーションをフォーカス0.1で示す。

【図26A】最適化したTE偏光照明のため、図4Bのウエハ構造による図4Aの煉瓦壁パターンのプリントのシミュレーションをフォーカス-0.3で示す。

【図26B】最適化したTE偏光照明のための、図4Bのウエハ構造による図4Aの煉瓦壁パターンのプリントのシミュレーションをフォーカス-0.25で示す。

【図26C】最適化したTE偏光照明のための、図4Bのウェハ構造による図4Aの煉瓦壁パターンのプリントのシミュレーションをフォーカス-0.2で示す。

【図26D】最適化したTE偏光照明のため、図4Bのウェハ構造による図4Aの煉瓦壁パターンのプリントのシミュレーションをフォーカス-0.15で示す。

【図26E】最適化したTE偏光照明のための、図4Bのウエハ構造による図4Aの煉瓦壁パターンのプリントのシミュレーションをフォーカス-0.1で示す。

【図26F】最適化したTE偏光照明のための、図4Bのウエハ構造による図4Aの煉瓦壁パターンのプリントのシミュレーションをフォーカス-0.05で示す。

【図26G】最適化したTE偏光照明のための、図4Bのウエハ構造による図4Aの煉瓦壁パターンのプリントのシミュレーションをフォーカス0で示す。

【図26H】最適化したTE偏光照明のための、図4Bのウエハ構造による図4Aの焼毛壁パターンのプリントのシミュレーションをフォーカス0.05で示す。

【図261】最適化したIE偏光照明のための、図4Bのり上八構造による図4Aの媒質壁パターンのプリントのシミュレーションをフォーカス0.1で示す。

【図27A】図16Aに示すフランクメンテーション魚1での画像対数勾配（TLS）プロットを示す。

【図27B】図16Aに示すノフクメンテーション点2での画像対数勾配(1LS)プロットを示す。

【図27C】図16Aに示すフラグメンテーション点3での画像対数勾配(ILS)プロットを示す。

【図28】ここに議論した構想を使って設計したマスクと共に使うのに適したリソグラフィ投影装置を概略的に描く。

【符号の説明】

【0080】

C 目標部分

E X ビーム拡大器

I L 照明器

L A 放射線源

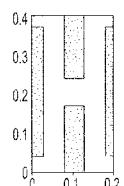
M A マスク

P L 投影システム

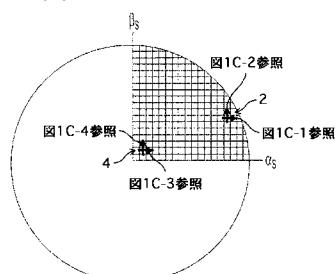
W 基板

10

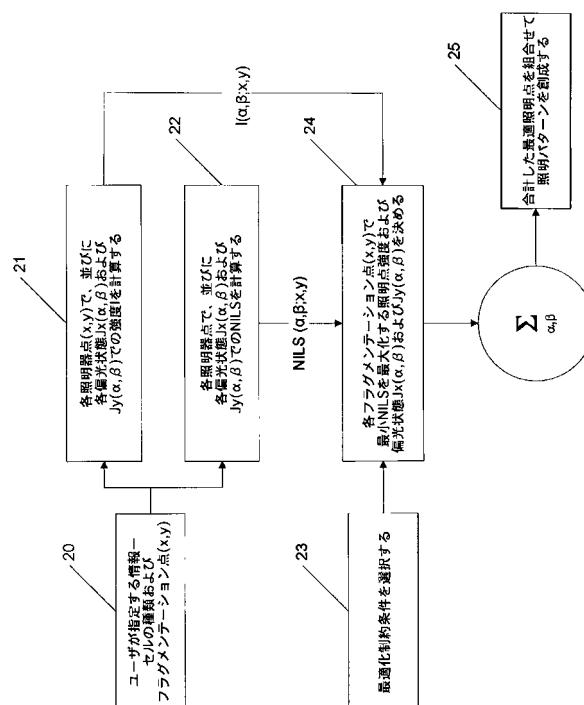
【図1A】



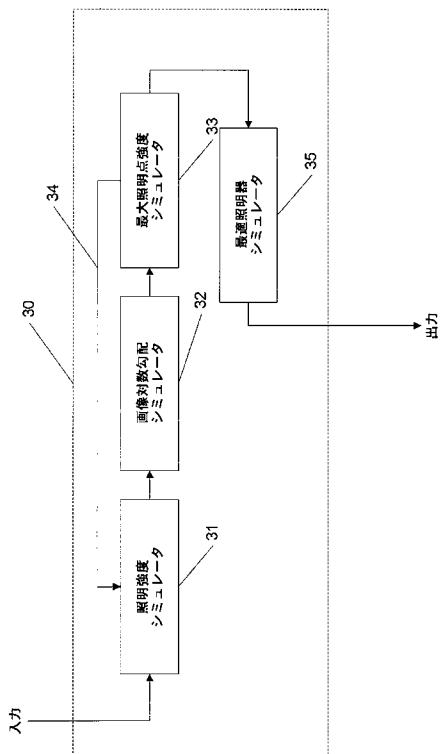
【図1B】



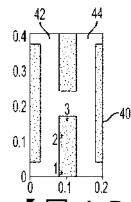
【図2】



【図3】



【図4 A】



【図4 B】

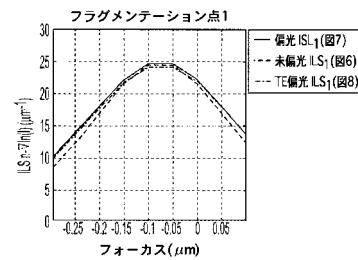
浸式

水 $n=1.437$

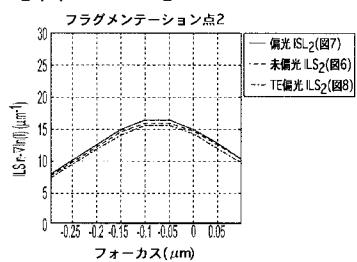
$180\text{nm} \wedge \lambda = 1.7-0.0$

基板 $n=1.7-0.0$

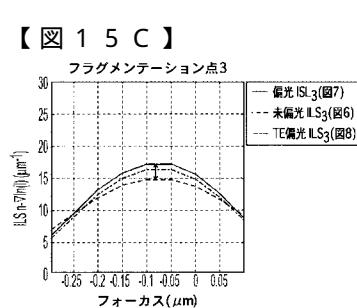
【図15 A】



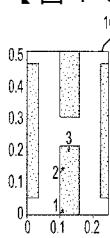
【図15 B】



【図15 C】



【図16 A】



【図16 B】

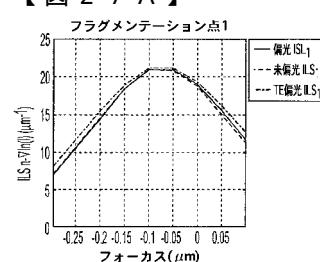
乾式

空気 $n=1.0$

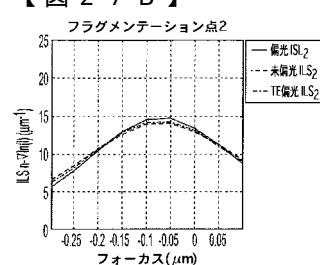
$180\text{nm} \wedge \lambda = 1.7-0.0$

基板 $n=1.7-0.0$

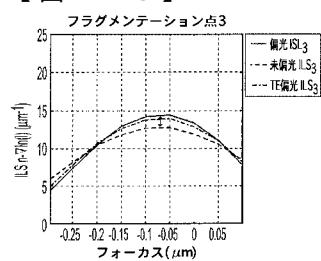
【図27 A】



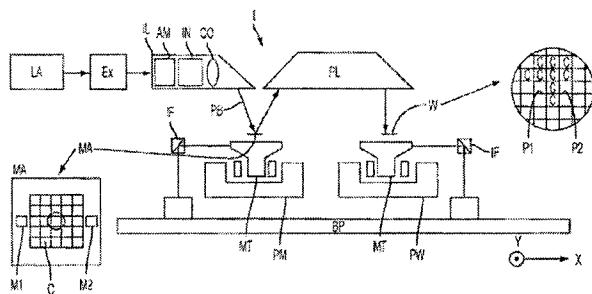
【図27 B】



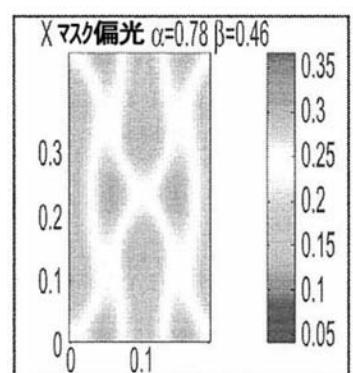
【図27C】



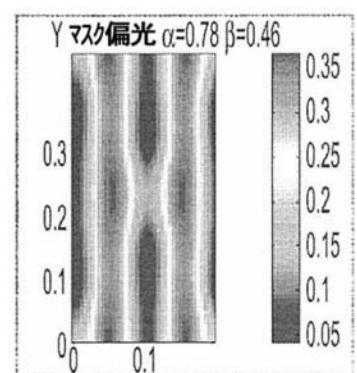
【図28】



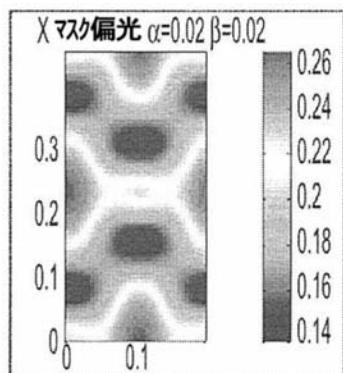
【図1C-1】



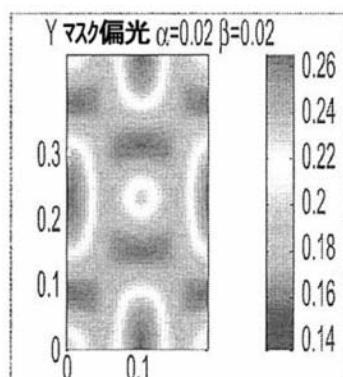
【図1C-2】



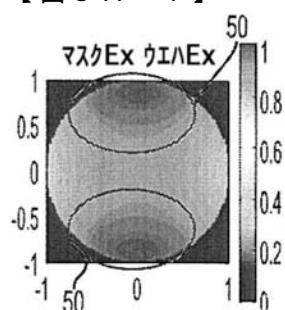
【図 1 C - 3】



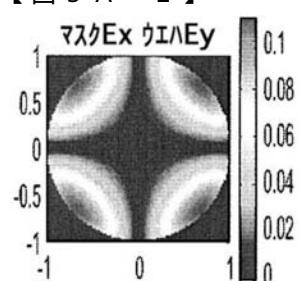
【図 1 C - 4】



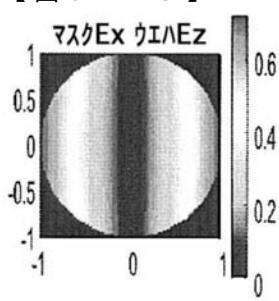
【図 5 A - 1】



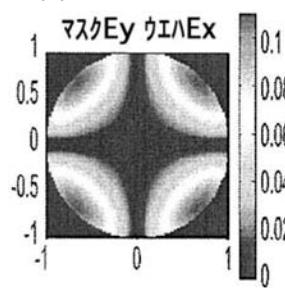
【図 5 A - 2】



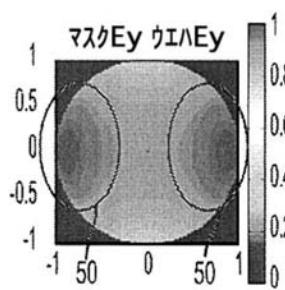
【図 5 A - 3】



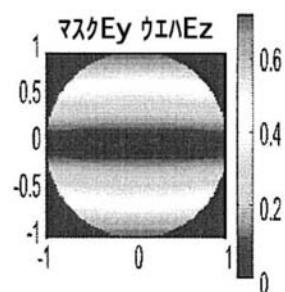
【図 5 B - 1】



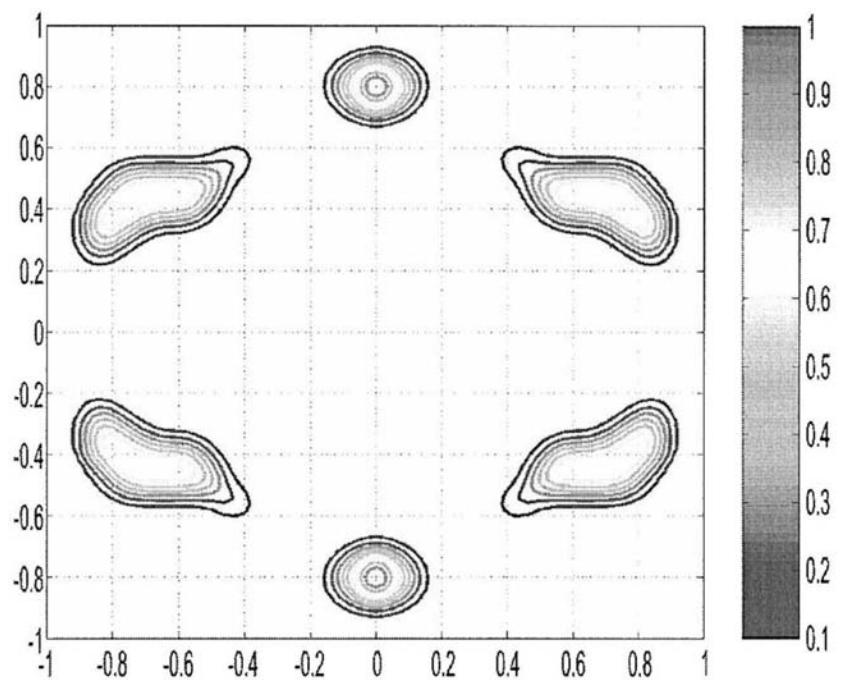
【図 5 B - 2】



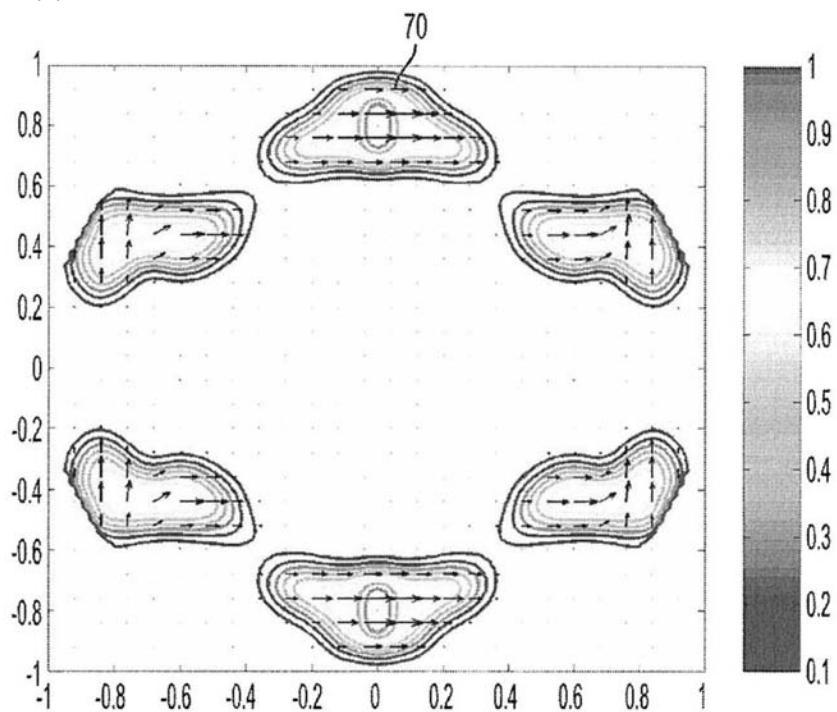
【図 5 B - 3】



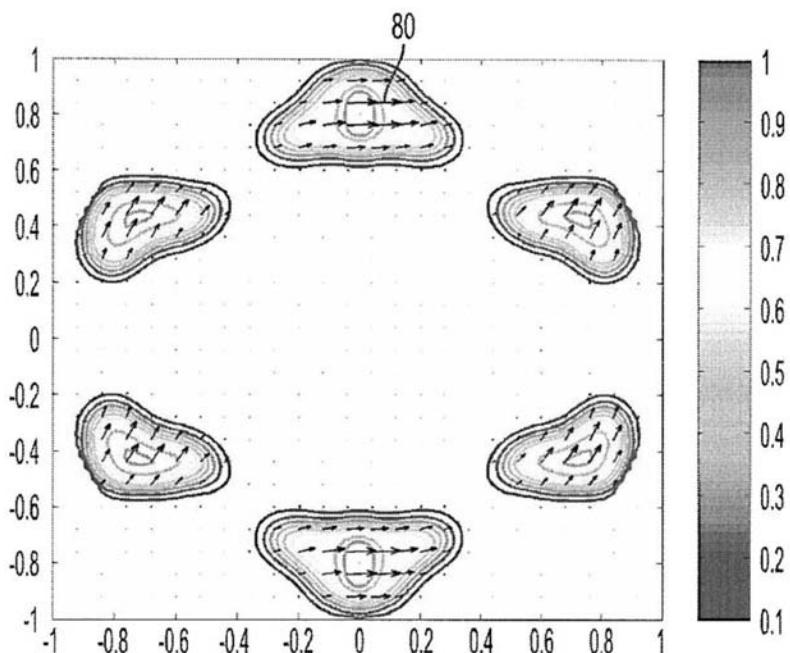
【図 6】



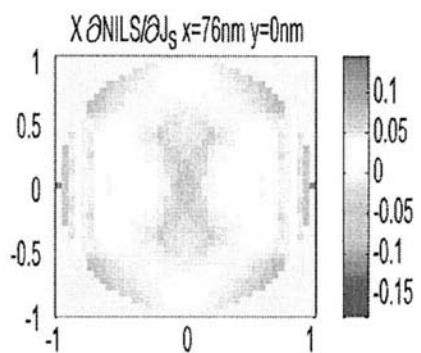
【図7】



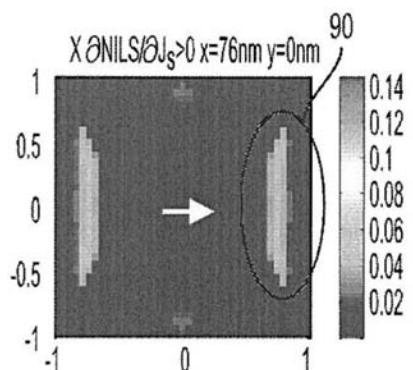
【図8】



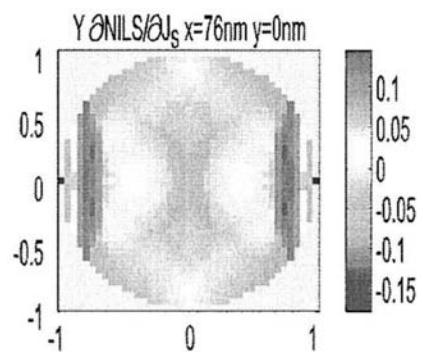
【図9A-1】



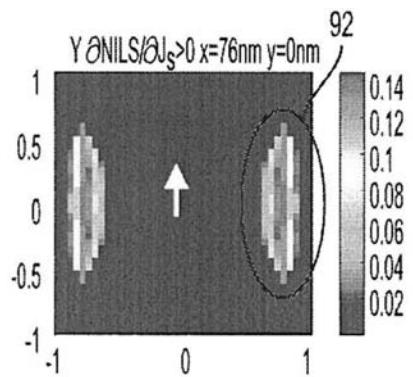
【図 9 A - 2】



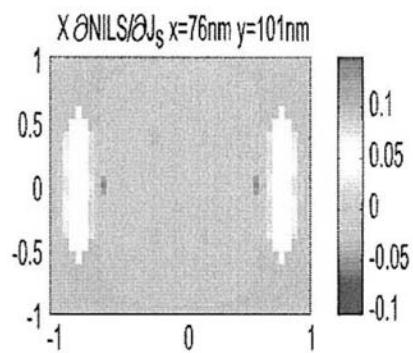
【図 9 B - 1】



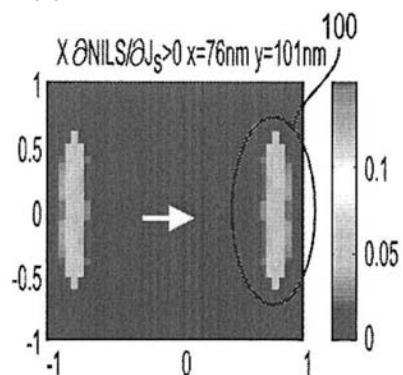
【図 9 B - 2】



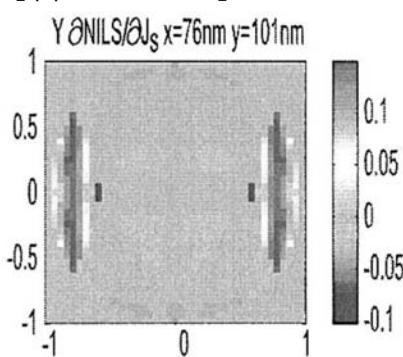
【図 10 A - 1】



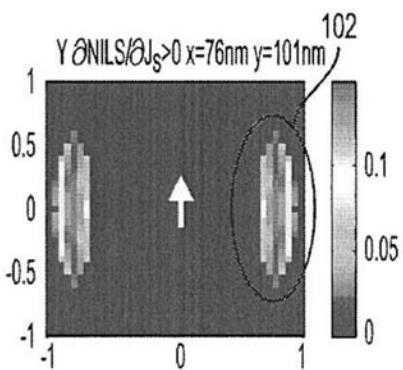
【図 1 0 A - 2】



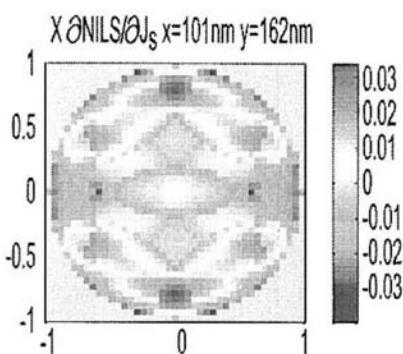
【図 1 0 B - 1】



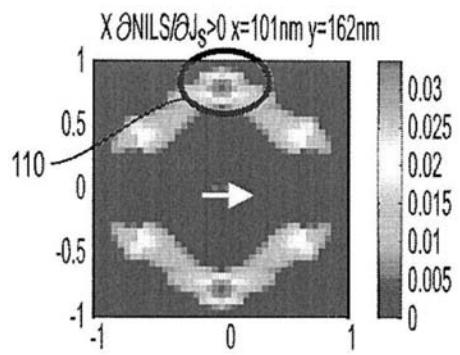
【図 1 0 B - 2】



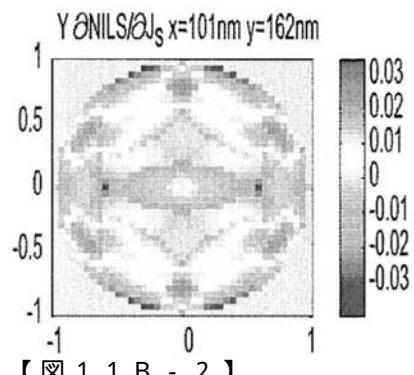
【図 1 1 A - 1】



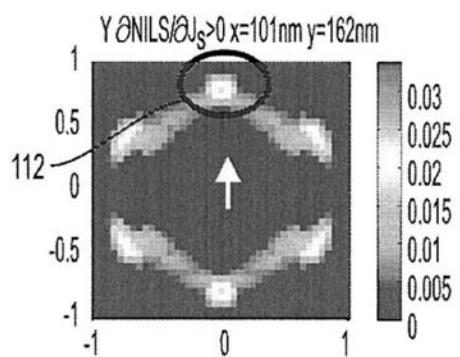
【図 1 1 A - 2】



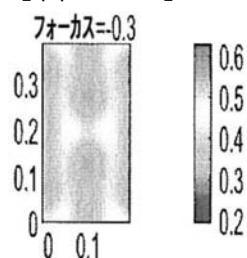
【図 1 1 B - 1】



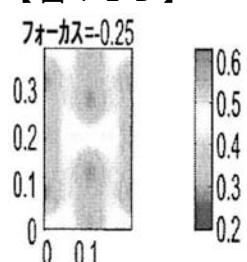
【図 1 1 B - 2】



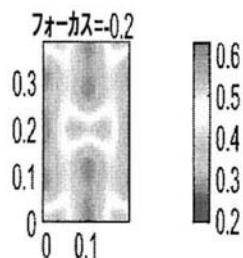
【図 1 2 A】



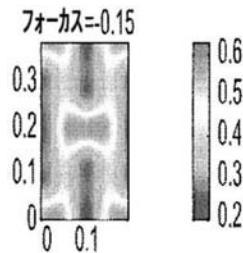
【図 1 2 B】



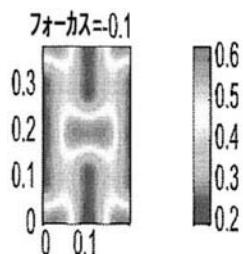
【図 1 2 C】



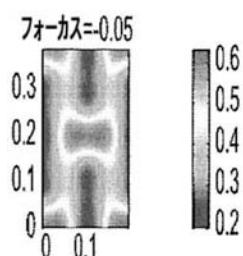
【図 1 2 D】



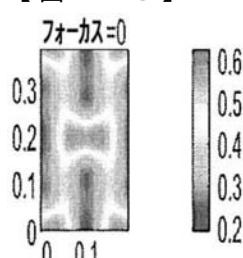
【図 1 2 E】



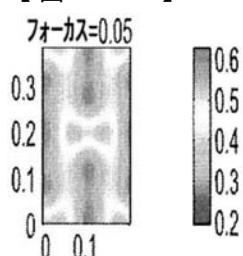
【図 1 2 F】



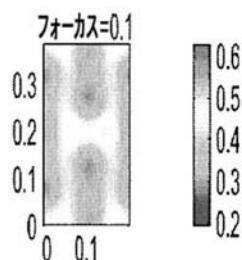
【図 1 2 G】



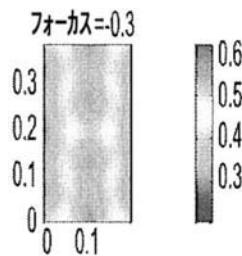
【図 1 2 H】



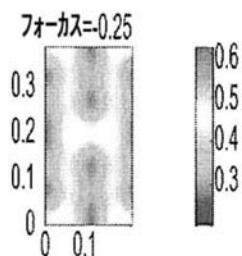
【図12I】



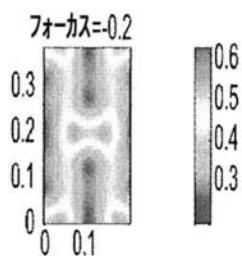
【図13A】



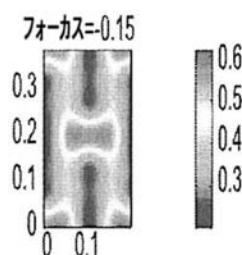
【図13B】



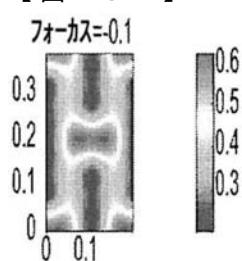
【図13C】



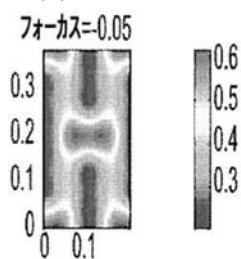
【図13D】



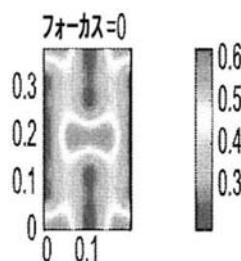
【図13E】



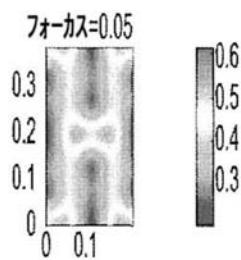
【図 1 3 F】



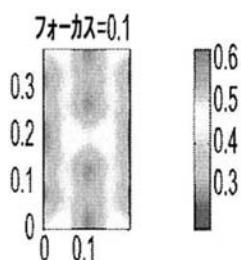
【図 1 3 G】



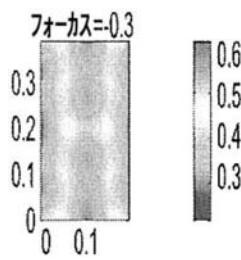
【図 1 3 H】



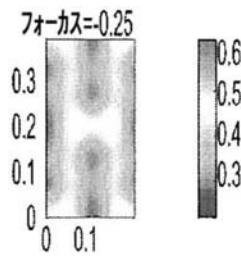
【図 1 3 I】



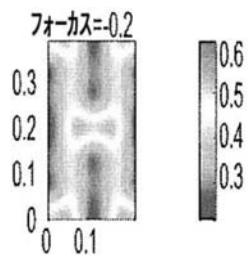
【図 1 4 A】



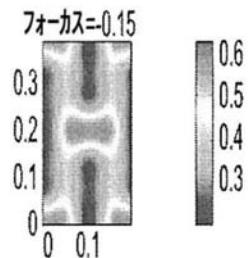
【図 1 4 B】



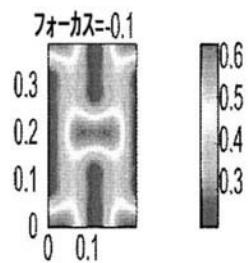
【図14C】



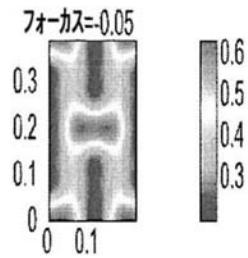
【図14D】



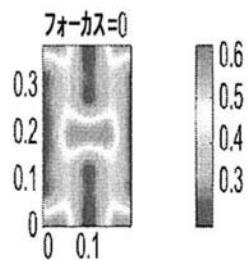
【図14E】



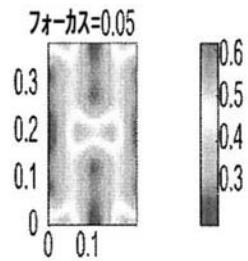
【図14F】



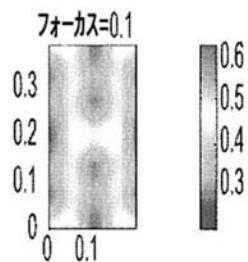
【図14G】



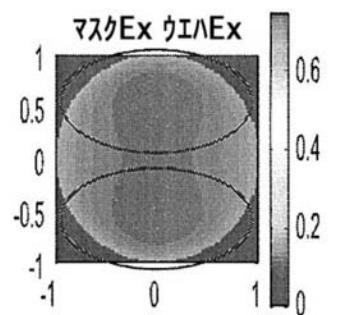
【図14H】



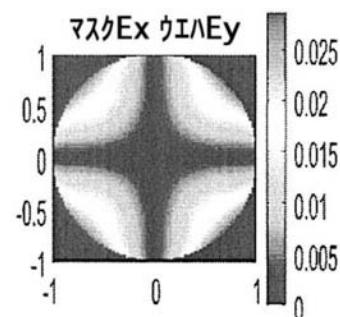
【図14Ⅰ】



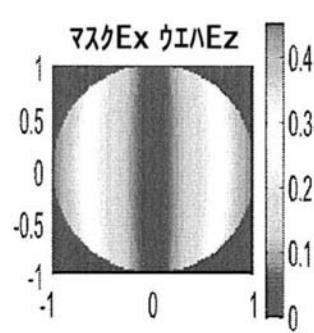
【図17A-1】



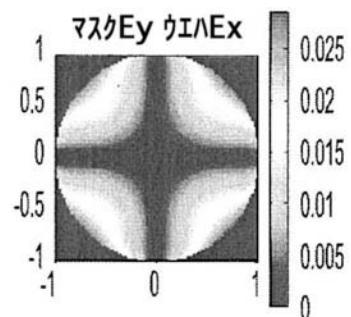
【図17A-2】



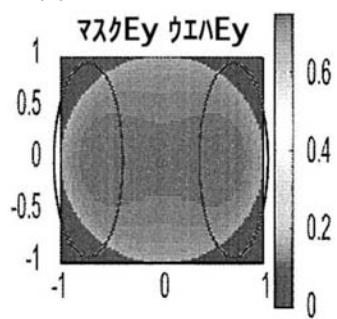
【図17A-3】



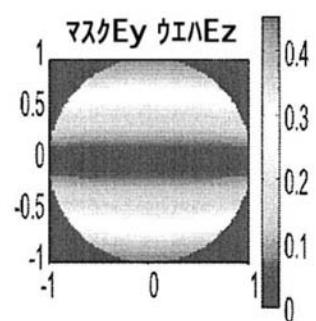
【図17B-1】



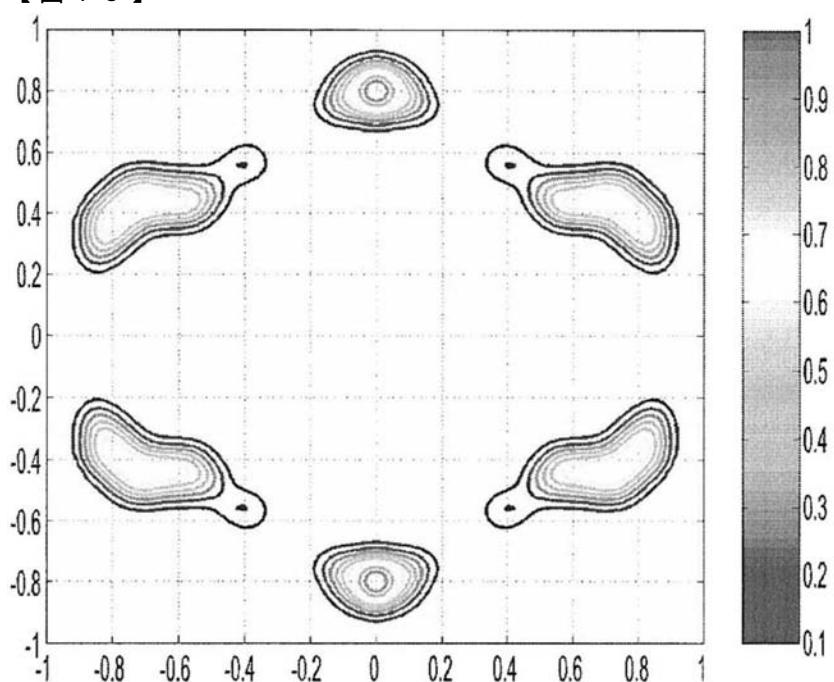
【図 1 7 B - 2】



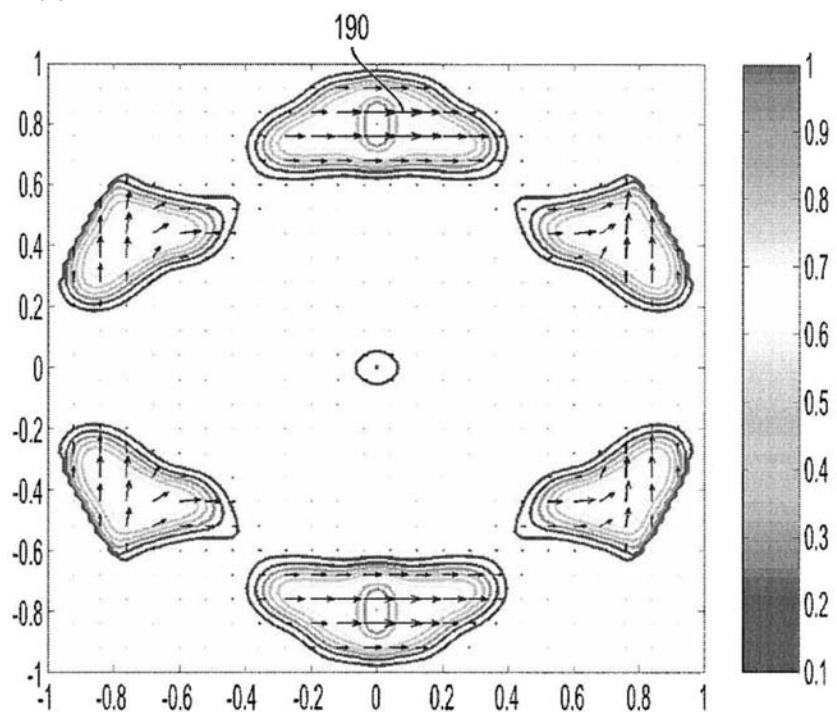
【図 1 7 B - 3】



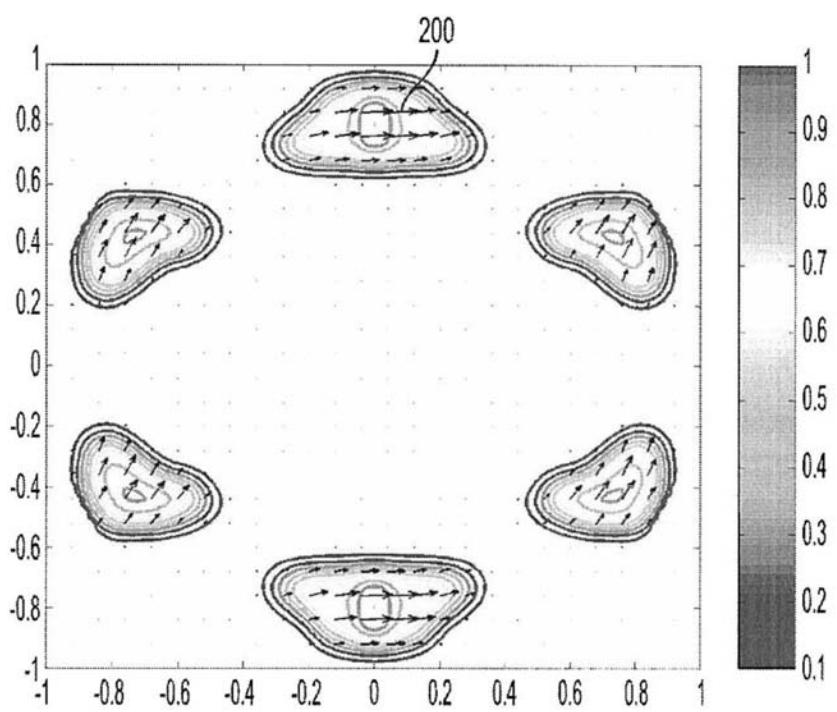
【図 1 8】



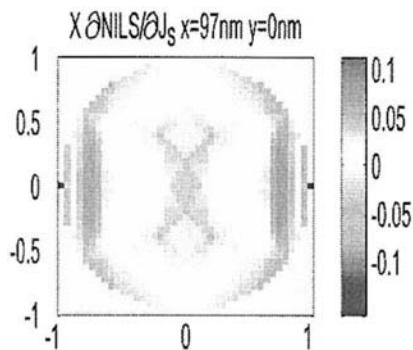
【図 19】



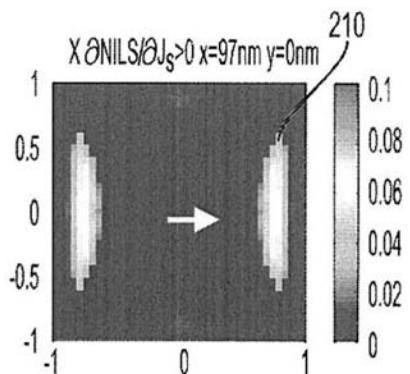
【図 20】



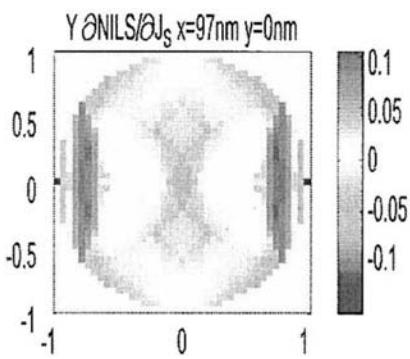
【図 21A-1】



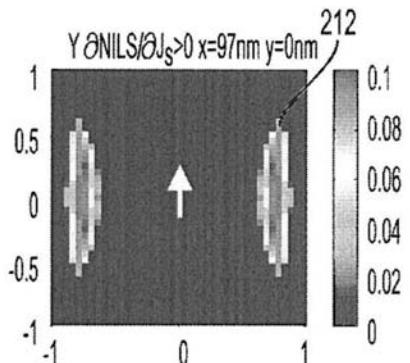
【図 2 1 A - 2】



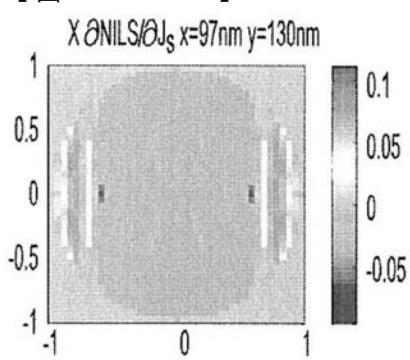
【図 2 1 B - 1】



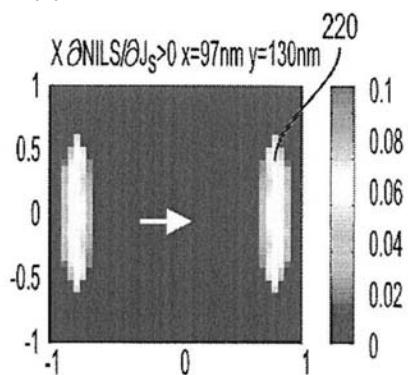
【図 2 1 B - 2】



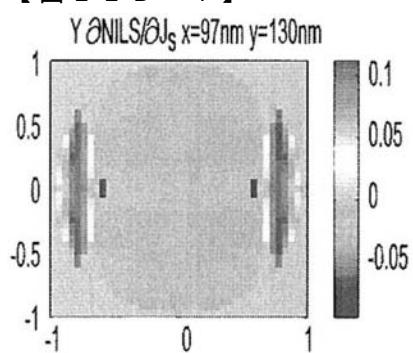
【図 2 2 A - 1】



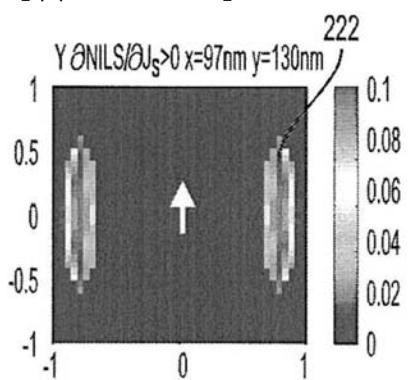
【図 2 2 A - 2】



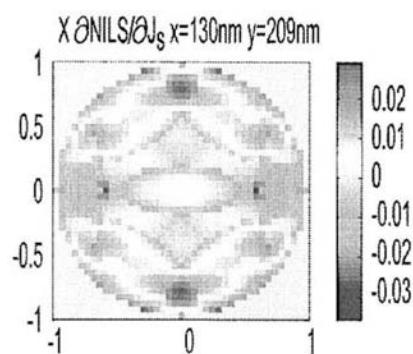
【図 2 2 B - 1】



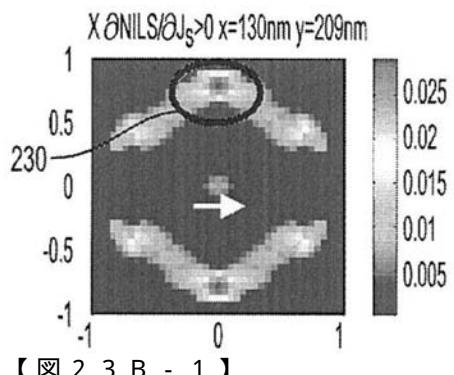
【図 2 2 B - 2】



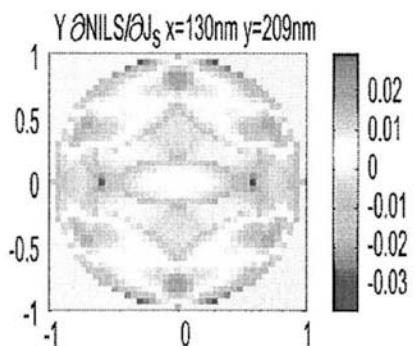
【図 2 3 A - 1】



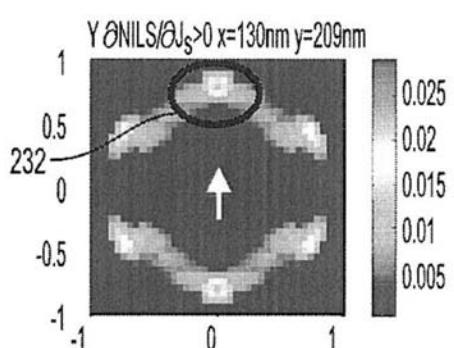
【図 2 3 A - 2】



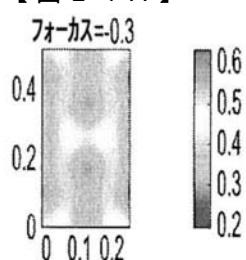
【図 2 3 B - 1】



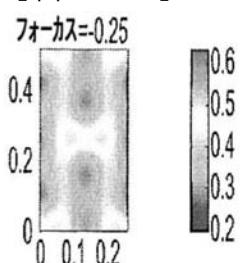
【図 2 3 B - 2】



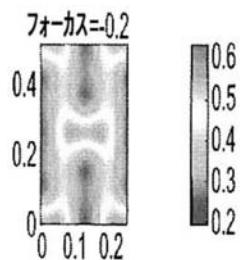
【図 2 4 A】



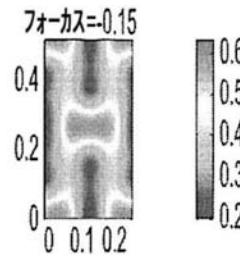
【図 2 4 B】



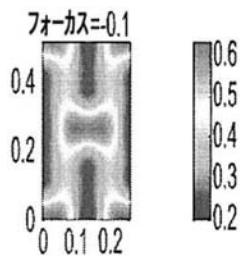
【図24C】



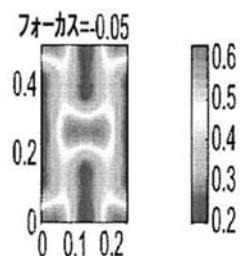
【図24D】



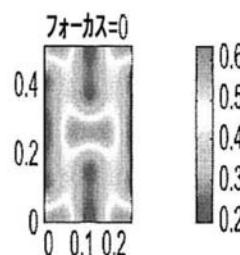
【図24E】



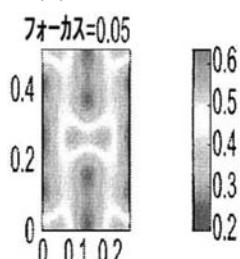
【図24F】



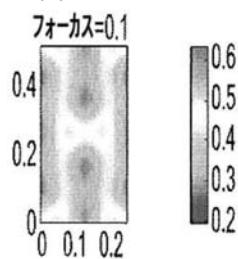
【図24G】



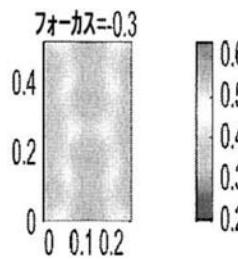
【図24H】



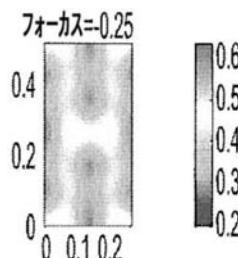
【図24】



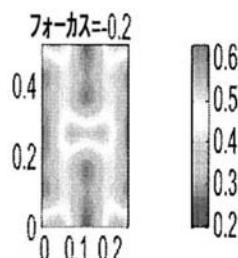
【図25】



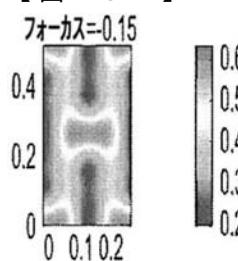
【図25】



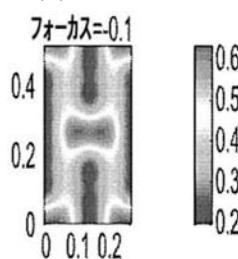
【図25】



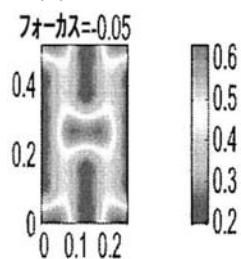
【図25】



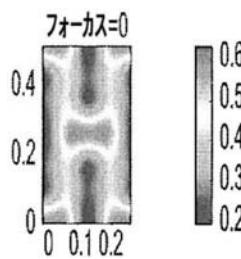
【図25】



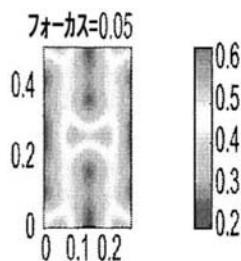
【図25F】



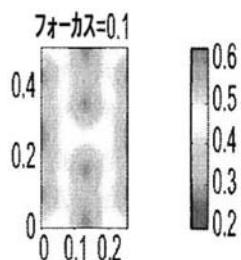
【図25G】



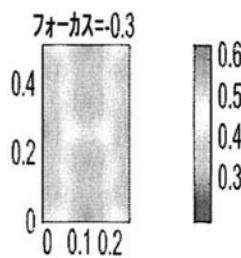
【図25H】



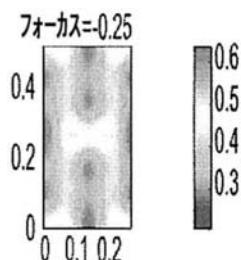
【図25I】



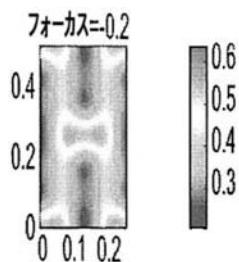
【図26A】



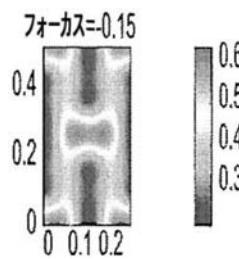
【図26B】



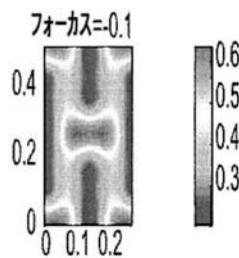
【図26C】



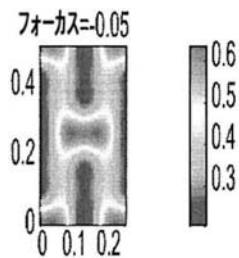
【図26D】



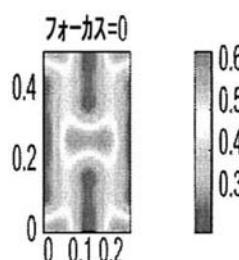
【図26E】



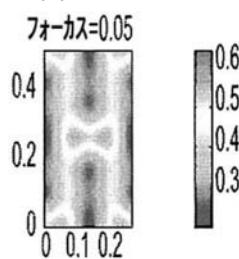
【図26F】



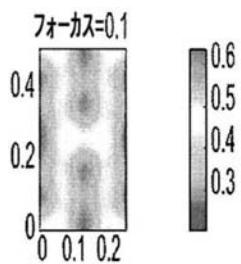
【図26G】



【図26H】



【図26Ⅰ】



フロントページの続き

(72)発明者 ドニス フラジェロ

アメリカ合衆国、アリゾナ、スコットデール、 イー・ファン タボ ロード 8118

(72)発明者 スティーヴン ジー・ハンセン

アメリカ合衆国、アリゾナ、フェニックス、 イー・デザート ウィロー ロード 3185

審査官 岩本 勉

(56)参考文献 特開平09-184918(JP,A)

特開2003-015273(JP,A)

特開2002-334836(JP,A)

特開2002-261004(JP,A)

特開2003-188087(JP,A)

国際公開第2005/041277(WO,A1)

特開2005-141242(JP,A)

特開平07-307268(JP,A)

特開平06-310396(JP,A)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)

H01L 21/027

G03F 7/20